仅供内部参考，请勿外传！

分析师：邹臣
登记编码：S0730523100001
zouchen@ccnew.com 021-50581991

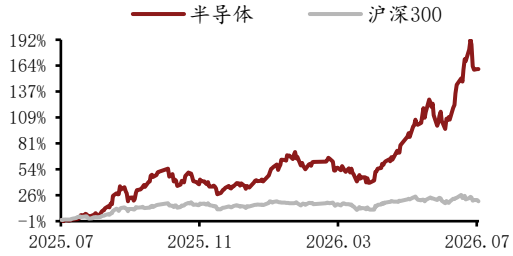
全球存储厂商加速扩产，关注半导体设备及零部件投资机会

——半导体行业月报

证券研究报告-行业月报　　强于大市(维持)

发布日期：2026 年 07 月 09 日

半导体相对沪深 300 指数表现



资料来源：聚源，中原证券研究所

相关报告

《半导体行业月报：华为发布韬定律，关注半导体产业链发展新机遇》 2026-06-15

《半导体行业月报：海外云厂商上调 26 年资本支出计划，CPU 重回 AI 数据中心核心》 2026-05-07

《半导体行业月报：国内半导体设备厂商密集发布新品，国产替代持续加速推进》 2026-04-13

联系人：李智
电话： 0371-65585629
地址： 郑州郑东新区商务外环路 10 号 18 楼
地址： 上海浦东新区世纪大道 1788 号 T1 座 22 楼

投资要点：

- **6 月国内半导体行业表现相对较强。**2026 年 6 月国内半导体行业（中信）上涨 38.02%，同期沪深 300 上涨 1.78%，其中集成电路上涨 30.58%，分立器件上涨 30.51%，半导体材料上涨 65.16%，半导体设备上涨 57.15%；半导体行业（中信）2026 年初至今上涨 106.90%。2026 年 6 月费城半导体指数上涨 11.05%，同期纳斯达克 100 下跌 0.19%，费城半导体指数 2026 年初至今上涨 101.14%。

- **全球半导体月度销售额继续同比高速增长，预计 26 年将大幅增长。**2026 年 5 月全球半导体销售额同比增长 104%，环比增长 9%；根据 WSTS 的最新预测，预计 2026 年全球半导体销售额将达到 1.511 万亿美元，同比增长 89.9%。下游需求呈现结构分化趋势，AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛，26Q1 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长 81%，环比增长 10%，并上调 2026 年资本支出计划；26Q1 国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本支出同比增长 18%，环比增长 28%。26Q1 中芯国际、华虹产能利用率环比小幅回落，仍处于满负荷运行状态。2026 年 6 月 DRAM 现货价格恢复环比上涨，NAND Flash 现货价格环比小幅下降，DRAM 指数环比上涨约 2.21%，NAND 指数环比下降约 0.90%；TrendForce 预计 26Q3 DRAM 及 NAND Flash 合约价格分别环比增长 13-18%及 10-15%。根据 SEAJ 的数据，全球半导体设备销售额 26Q1 同比增长 14%，中国半导体设备销售额 26Q1 同比增长 7%，2026 年 5 月日本半导体设备销售额同比增长 17.9%，环比增长 3.2%；SEMI 预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出将增长 18%至 1330 亿美元。全球硅片出货量 26Q1 同比增长 13.1%，环比下降 4.7%，SEMI 预计 2026 年全球硅片出货量将继续增长 5.2%。综上所述，我们认为目前半导体行业仍处于上行周期，AI 为推动半导体行业成长的重要动力。

- **投资建议。**近日韩国宣布 AI 超级投资规划，韩国将投入 800 万亿韩元在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造厂；同时三星集团计划投资总额达 2655 万亿韩元，其中计划投资 2030 万亿韩元在韩国龙仁市和平泽市建设半导体产业集群；SK 集团计划投资总额达 2100 万亿韩元，其中计划 1100 万亿韩元用于新建多处半导体产业集群。美光上调 2027 财年资本支出计划，预计将超过 400 亿美元。受益于 AI 基础设施投资的不断扩张，AI 驱动对先进存储需求持续旺盛，全球存储制造商正在加速扩大产能，根据 SEMI 的最新预测，预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资将达到 520 亿美元，同比增长 29%，预计 2024-2029 年复合增速将达 19%。AI 驱动全球存储厂商加速扩产，半导体设备供给紧张程度有望逐步提升，国产半导体设备出海有望加速，同时叠加半导体设备国产替代在持续推进中，建议关注国内半导体设

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

备及零部件厂商的投资机会。

风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧风险，国内厂商研发进展不及预期，国产化进度不及预期，国际地缘政治冲突加剧风险。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

内容目录

1. 2026 年 6 月半导体行业市场表现情况 6
1.1. 6 月半导体行业股票市场表现情况 6
1.2. 6 月半导体行业可转债市场表现情况 8
1.3. 6 月半导体行业 ETF 市场表现情况 9
2. 全球半导体月度销售额继续同比高速增长，预计 26 年将大幅增长 9
2.1. 全球半导体月度销售额继续同比高速增长 9
2.2. 2026 年全球 AI 眼镜出货量有望快速增长，AI 算力硬件基础设施需求旺盛 13
2.2.1. 全球智能手机季度出货量小幅增长，预计 2026 年全球智能手机市场将有所承压 13
2.2.2. 全球 PC 季度出货量继续同比增长，预计 2026 年全球 PC 出货量大幅下降 18
2.2.3. AI 眼镜是端侧 AI 最佳硬件载体之一，2026 年全球 AI 眼镜出货量有望快速增长 23
2.2.4. 国内外云厂商不断提升资本支出，推动 AI 算力硬件基础设施需求旺盛 28
2.2.5. 中国新能源汽车月度销量同比稳健增长 29
2.3. 全球部分芯片厂商季度库存水位环比小幅提升，国内部分芯片厂商季度库存水位环比大幅提升 30
2.4. 国内主要晶圆厂季度产能利用率环比小幅回落 31
2.5. DRAM 月度现货价格环比恢复上涨，NAND Flash 现货价格环比小幅下降 32
2.6. 全球半导体设备季度销售额继续同比增长，预计 2026 年有望持续增长 34
2.7. 全球硅片季度出货量继续同比增长，预计 2026 年将持续增长 36
3. 行业政策 37
4. 行业动态 38
4.1. 全球半导体行业动态 38
4.2. 河南省半导体行业动态 42
5. 估值分析与投资建议 43
5.1. 估值分析 43
5.2. 投资建议 44
6. 风险提示 44

图表目录

图 1：2026 年 6 月中信一级行业涨跌幅情况（%） 6
图 2：中信半导体指数与沪深 300 涨跌幅情况（%） 6
图 3：费城半导体指数与纳斯达克 100 涨跌幅情况（%） 7
图 4：2000-2026 年全球半导体市场销售额情况 10
图 5：2015-2026 年中国半导体市场销售额情况 10
图 6：2018-2029 年全球半导体销售额及预测情况（十亿美元） 11
图 7：2020-2027 年全球集成电路分产品市场预测情况 11
图 8：2024 年全球半导体下游应用领域占比情况 13
图 9：22Q1-26Q1 全球智能手机出货量情况 14
图 10：23Q1-26Q1 全球智能手机厂商市场份额情况 14
图 11：手机智能化演进路线图 15
图 12：AI 手机带来手机全栈革新和生态重构 15
图 13：AI 手机生态系统及主要参与者情况 16
图 14：2024-2029 年全球 AI 手机出货量及预测情况 18
图 15：23Q1-26Q1 年全球 PC 季度出货量情况 19
图 16：2016-2027 年全球 PC 出货量及预测情况 20
图 17：Canalys 对 AI PC 的定义及未来演变的考量 20
图 18：微软和英特尔对 AI PC 的定义 20
图 19：23Q4-24Q4 全球 AI PC 出货量情况 22
图 20：24Q1-25Q4 全球 PC 及 AI PC 出货量及预测 22
图 21：2024-2028 年全球 PC 市场总收入预测情况 23

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

图 22：Ray-Ban Meta 产品示意图 23
图 23：Ray-Ban Meta 产品支持耳机功能 23
图 24：AI 眼镜产品形态分类情况 24
图 25：拍照 AI 眼镜为当前主流形态 24
图 26：23Q4-24Q4 Ray-Ban Meta 眼镜出货量情况 24
图 27：小度 AI 眼镜产品示意图 24
图 28：小度 AI 眼镜产品配置及功能情况 24
图 29：华为智能眼镜 2 产品示意图 25
图 30：华为智能眼镜 2 产品示意图 25
图 31：雷鸟 V3 AI 眼镜产品示意图 25
图 32：雷鸟 X3 Pro AR 眼镜产品示意图 25
图 33：Oakley Meta HSTN AI 眼镜产品示意图 26
图 34：Oakley Meta HSTN AI 眼镜产品示意图 26
图 35：小米 AI 眼镜产品示意图 26
图 36：小米 AI 眼镜产品示意图 26
图 37：2023-2025 年全球 AI 眼镜出货量情况 27
图 38：2025 年全球及中国大陆 AI 眼镜市场竞争格局情况 27
图 39：RayBan Meta AI 眼镜系统架构框图 28
图 40：RayBan Meta AI 眼镜成本结构图 28
图 41：2020-2025 年北美四大云厂商资本开支情况（亿美元） 28
图 42：2021-2026 年国内三大互联网厂商资本开支情况（百万元） 29
图 43：2000-2026 年中国汽车销量情况 29
图 44：2015-2026 年中国新能源汽车销量情况 30
图 45：全球部分芯片厂商平均库存周转天数情况 30
图 46：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况 31
图 47：全球部分晶圆厂产能利用率情况 31
图 48： 2024-2028 年全球晶圆产能及预测情况 32
图 49： 25H2-26H2 晶圆代工价格涨幅变化情况 32
图 50：DRAM 指数走势情况 33
图 51：DRAM 现货价格走势情况（美元） 33
图 52：NAND 指数走势情况 33
图 53：NAND Flash 现货价格走势情况（美元） 33
图 54：26Q2-26Q3 DRAM 及 NAND Flash 产品合约价格预测情况 34
图 55：2005-2026 年全球半导体设备销售额情况 34
图 56：2005-2026 年中国半导体设备销售额情况 34
图 57：日本半导体设备月度销售额情况 35
图 58：2024-2029 年全球 300mm 晶圆厂设备支出情况及预测 35
图 59：2024-2029 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资情况及预测 36
图 60：全球硅片出货量情况 36
图 61：2022-2027 年全球硅片出货量情况及预测 37
图 62：近十年半导体（申万）PE Bands 44

表 1：2026 年 6 月 A 股中信半导体行业部分个股涨跌幅情况 6
表 2：2026 年 6 月美股主要半导体公司涨跌幅情况 8
表 3：2026 年 6 月国内半导体行业可转债涨跌幅情况（截至 2026 年 7 月 3 日） 8
表 4：2026 年 6 月国内半导体行业 ETF 涨跌幅情况（截至 2026 年 7 月 3 日） 9
表 5：全球前十五大芯片公司 26Q1 营收情况及 26 年展望 12
表 6：全球部分处理器厂商发布的支持端侧 AI 大模型手机的 SoC 芯片情况 16
表 7：全球部分智能手机厂商旗舰 AI 手机布局情况 17
表 8：26Q1 全球 PC 厂商市场份额情况 19
表 8：全球主要处理器厂商发布的适用于 AI PC 处理器情况 21
表 9：全球部分 PC 厂商 AI PC 布局情况 21
表 10：近年美日荷对中国半导体产业部分制裁政策情况 37

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

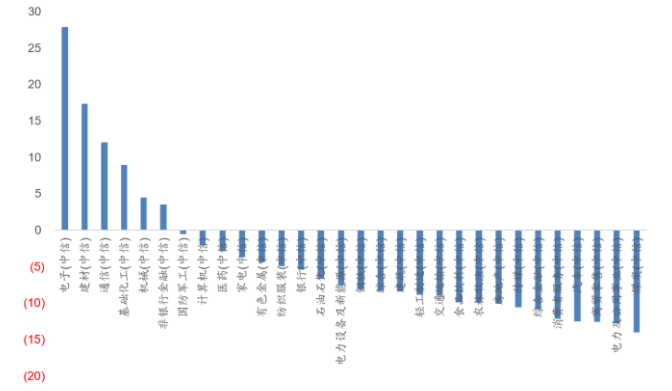
仅供内部参考，请勿外传！

1. 2026 年 6 月半导体行业市场表现情况

1.1. 6 月半导体行业股票市场表现情况

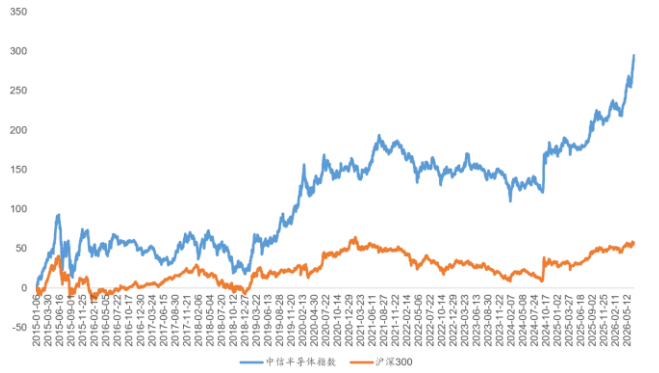
国内 2026 年 6 月半导体行业表现相对较强，走势大幅强于沪深 300。2026 年 6 月电子行业（中信）上涨 27.86%，6 月沪深 300 上涨 1.78%，电子行业走势大幅强于沪深 300 指数。半导体行业（中信）2026 年 6 月上涨 38.02%，走势大幅强于沪深 300，其中集成电路上涨 30.58%，分立器件上涨 30.51%，半导体材料上涨 65.16%，半导体设备上涨 57.15%；半导体行业（中信）2026 年初至今上涨 106.90%。

图 1：2026 年 6 月中信一级行业涨跌幅情况（%）



资料来源：Wind，中原证券研究所

图 2：中信半导体指数与沪深 300 涨跌幅情况（%）



资料来源：Wind，中原证券研究所

2026 年 6 月半导体板块上涨家数远多于下跌家数，2026 年 6 月涨幅排名前十的公司分别为神工股份（151%）、有研新材（135%）、有研硅（110%）、雅克科技（109%）、富创精密（103%）、中船特气（101%）、普冉股份（99 %）、中科飞测（97%）、华峰测控（96%）、江丰电子（94%）。

表 1：2026 年 6 月 A 股中信半导体行业部分个股涨跌幅情况

证券代码	证券名称	总市值（亿元）	6 月涨跌幅（%）	年初至今涨跌幅（%）	市盈率（TTM）	市销率（TTM）	市净率
688233.SH	神工股份	365	151	207	369	82	19
600206.SH	有研新材	564	135	229	197	5	13
688432.SH	有研硅	500	110	223	238	46	11
002409.SZ	雅克科技	1,068	109	204	106	13	13
688409.SH	富创精密	938	103	354	1,312	25	21
688146.SH	中船特气	1,853	101	767	515	76	32
688766.SH	普冉股份	1,140	99	503	259	34	42
688361.SH	中科飞测	1,506	97	181	26,645	70	30
688200.SH	华峰测控	1,053	96	310	185	74	25
300666.SZ	江丰电子	1,017	94	301	184	21	20
688082.SH	盛美上海	2,085	89	145	166	30	15
688403.SH	汇成股份	393	88	143	388	22	10
300346.SZ	南大光电	640	80	117	184	24	18
688037.SH	芯源微	885	79	196	1,255	44	32
688286.SH	敏芯股份	65	76	46	283	11	6
603986.SH	兆易创新	5,791	75	281	199	50	23
002119.SZ	康强电子	150	74	143	129	6	11
688120.SH	华海清科	1,594	73	201	145	32	21
603061.SH	金海通	437	70	419	187	51	26

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

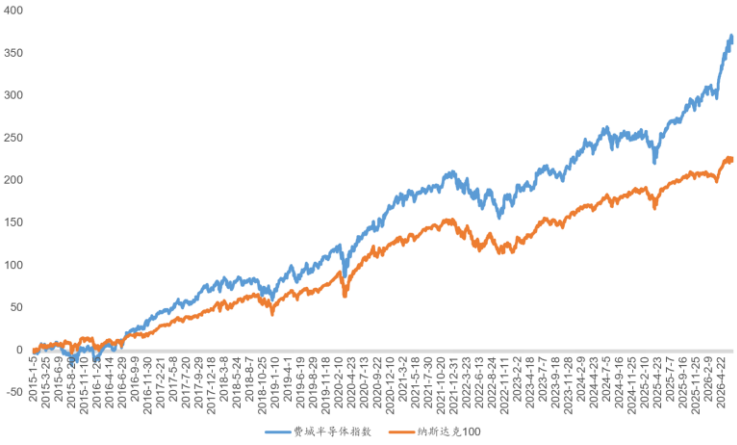
仅供内部参考，请勿外传！

688689.SH	银河微电	85	68	129	91	8	7
688332.SH	中科蓝讯	281	67	80	21	15	5
688498.SH	源杰科技	2,348	66	326	659	269	93
300604.SZ	长川科技	2,166	62	237	138	37	43
688141.SH	杰华特	691	60	253	-79	24	55
688123.SH	聚辰股份	338	60	70	115	27	13
300223.SZ	北京君正	1,204	58	135	194	23	9
600460.SH	士兰微	910	58	92	198	7	7
688012.SH	中微公司	4,463	57	156	164	34	18
688535.SH	华海诚科	268	56	147	868	44	12
688019.SH	安集科技	772	56	103	94	29	17
688798.SH	艾为电子	171	-1	-3	56	6	4
688099.SH	晶晨股份	436	-3	18	51	6	6
688508.SH	芯朋微	123	-4	54	77	11	4
688270.SH	ST 臻镭	235	-8	-10	156	49	10
688693.SH	锴威特	77	-9	178	-80	28	10
300672.SZ	国科微	640	-10	174	-279	30	17
300831.SZ	ST 派瑞	62	-12	76	105	28	6
300183.SZ	东软载波	48	-15	-30	-301	5	2
300211.SZ	*ST 亿通	22	-15	-15	-77	11	5
300456.SZ	赛微电子	311	-15	-23	22	47	5

资料来源：Wind，中原证券研究所

2026 年 6 月费城半导体指数表现大幅强于纳斯达克 100。2026 年 6 月费城半导体指数上涨 11.05%，6 月纳斯达克 100 下跌 0.19%，费城半导体指数走势大幅强于纳斯达克 100；费城半导体指数 2026 年初至今上涨 101.14%。

图 3：费城半导体指数与纳斯达克 100 涨跌幅情况（%）



资料来源：Wind，中原证券研究所

2026 年 6 月美股半导体板块上涨家数略多于下跌家数，2026 年 6 月涨幅排名前十的公司分别为超科林半导体（67%）、应用材料（61%）、科磊（57%）、Ichor Holdings（57%）、盛美（47%）、Onto Innovation（47%）、Allegro（45%）、迈威尔科技（45%）、Astera（41%）、科休半导体（40%）。

仅供内部参考，请勿外传！

表 2：2026 年 6 月美股主要半导体公司涨跌幅情况

证券代码	证券名称	总市值（亿元）	6 月涨跌幅（%）	年初至今涨跌幅（%）	市盈率（TTM）	市销率（TTM）	市净率
UCTT.O	超科林半导体	64	67	463	(33)	3	10
AMAT.O	应用材料	5740	61	182	67	20	24
KLAC.O	科磊	3941	57	149	84	30	68
ICHR.O	Ichor Holdings	39	57	509	(77)	4	6
ACMR.O	盛美	88	47	222	96	9	6
ONTO.N	Onto Innovation	188	47	140	177	18	9
ALGM.O	Allegro	130	45	164	(871)	15	14
MRVL.O	迈威尔科技	2606	45	251	103	30	14
ALAB.O	Astera	828	41	190	309	83	55
COHU.O	科休半导体	35	40	218	(63)	7	5
MXL.O	MaxLinear	115	38	635	(87)	23	25
MKSI.O	MKS 仪器	300	37	179	92	7	11
LRCX.O	拉姆研究	5419	36	154	81	25	51
AIP.O	Arteris	22	35	213	(65)	29	866
KLIC.O	库力索法半导体	70	32	195	127	9	8
VECO.O	维易科精密仪器	46	32	165	200	7	5
ENTG.O	英特格	274	30	114	104	8	7
TER.O	泰瑞达	757	29	150	89	20	24
FORM.O	FormFactor	125	28	187	182	15	12
ACLS.O	亚舍立科技	58	26	136	58	7	6
HIMX.O	奇景光电	27	(24)	90	84	3	3
LEDS.O	旭明光电	0.1	(26)	11	(6)	0	9
QCOM.O	高通	1948	(26)	9	20	4	7
DVLT.O	Datavault AI	3	(30)	(46)	(2)	7	1
AXTI.O	AXT	47	(30)	341	(333)	49	17
CAN.O	嘉楠科技	2	(31)	(58)	(1)	0	1
NA.O	纳比特	0.4	(31)	(41)	2	11	0
NVTS.O	纳微半导体	42	(33)	151	(31)	103	10
VLN.N	Valens Semiconductor	2	(36)	59	(8)	3	2
MX.N	美格纳半导体	2	(46)	85	(7)	1	1

资料来源：iFinD，中原证券研究所

1.2. 6 月半导体行业可转债市场表现情况

2026 年 6 月国内半导体行业可转债全面上涨，其中鼎龙转债（64.80%）、微导转债（64.79%）、华亚转债（58.14%）、银微转债（42.66%）、颀中转债（34.40%）涨幅居前

表 3：2026 年 6 月国内半导体行业可转债涨跌幅情况（截至 2026 年 7 月 3 日）

代码	证券名称	评级	余额（亿元）	剩余期限（年）	转股溢价率（%）	2026 年 6 月涨跌幅（%）	2026 年初至今涨跌幅（%）	现价
123255.SZ	鼎龙转债	AA	9.10	4.75	42.09	64.80	148.02	450.00
118058.SH	微导转债	AA	11.70	5.09	21.87	64.79	44.47	472.27
127079.SZ	华亚转债	A+	0.60	0.02	-1.01	58.14	84.47	325.00
118011.SH	银微转债	A+	3.27	2.00	-1.00	42.66	67.00	216.91
118059.SH	颀中转债	AA+	8.50	5.34	44.60	34.40	50.36	222.71
118056.SH	路维转债	AA-	6.14	4.94	27.19	29.25	72.30	336.57
123124.SZ	晶瑞转 2	A+	5.22	1.12	23.75	16.55	9.35	149.38
118040.SH	宏微转债	A	4.29	3.06	2.32	9.53	-10.77	132.90
123122.SZ	富瀚转债	A+	5.80	1.09	65.31	6.16	9.34	130.71
127038.SZ	国微转债	AA+	14.92	0.94	60.98	3.67	3.25	135.70
118015.SH	芯海转债	A+	4.10	2.05	84.24	2.29	8.15	133.59
110081.SH	闻泰转债	BBB+	77.06	1.07	-0.67	1.85	-14.37	98.73
118036.SH	力合转债	AA-	3.80	2.99	50.48	1.03	6.05	140.31

资料来源：Wind，中原证券研究所

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

1.3. 6 月半导体行业 ETF 市场表现情况

2026 年 6 月国内半导体行业 ETF 全面上涨，其中鹏华科创板半导体材料设备主题 ETF（66.88%）、华夏上证科创板半导体材料设备主题 ETF（66.27%）、华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF（65.14%）、华夏中证半导体材料设备主题 ETF（62.33%）、广发中证半导体材料设备主题 ETF（61.98%）涨幅居前。

表 4：2026 年 6 月国内半导体行业 ETF 涨跌幅情况（截至 2026 年 7 月 3 日）

代码	证券名称	上市日期	现有规模（亿元）	2026 年 6 月涨跌幅（%）	2026 年初至今涨跌幅（%）
589020.SH	鹏华科创板半导体材料设备主题 ETF	2025/9/4	27.52	66.88	136.25
588170.SH	华夏上证科创板半导体材料设备主题 ETF	2025/4/8	245.41	66.27	135.76
588710.SH	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF	2025/6/4	55.68	65.14	134.75
562590.SH	华夏中证半导体材料设备主题 ETF	2023/10/18	84.82	62.33	126.60
560780.SH	广发中证半导体材料设备主题 ETF	2023/12/12	120.75	61.98	126.31
159558.SZ	易方达中证半导体材料设备主题 ETF	2024/6/18	171.13	61.80	125.82
159516.SZ	国泰中证半导体材料设备主题 ETF	2023/7/27	422.99	61.37	124.97
159327.SZ	万家中证半导体材料设备主题 ETF	2024/8/5	23.61	61.29	125.62
561980.SH	招商中证半导体产业 ETF	2023/9/1	70.01	50.81	101.96
159582.SZ	博时中证半导体产业 ETF	2024/4/16	7.34	50.61	102.52
512480.SH	国联安中证全指半导体 ETF	2019/6/12	226.92	38.00	81.10
159325.SZ	南方中证半导体行业精选 ETF	2024/11/8	15.02	36.95	76.83
588200.SH	嘉实上证科创板芯片 ETF	2022/10/26	572.53	36.57	84.91
512760.SH	国泰 CES 半导体芯片 ETF	2019/6/12	127.77	35.73	73.29
159995.SZ	华夏国证半导体芯片 ETF	2020/2/10	335.09	35.11	72.22
159801.SZ	广发国证半导体芯片 ETF	2020/2/18	61.01	35.01	71.88
159813.SZ	鹏华国证半导体芯片 ETF	2020/5/25	71.92	34.92	71.80
159665.SZ	工银瑞信国证半导体芯片 ETF	2023/1/6	6.13	34.85	73.48
513310.SH	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体 ETF	2022/12/22	120.67	17.97	106.02

资料来源：Wind，中原证券研究所

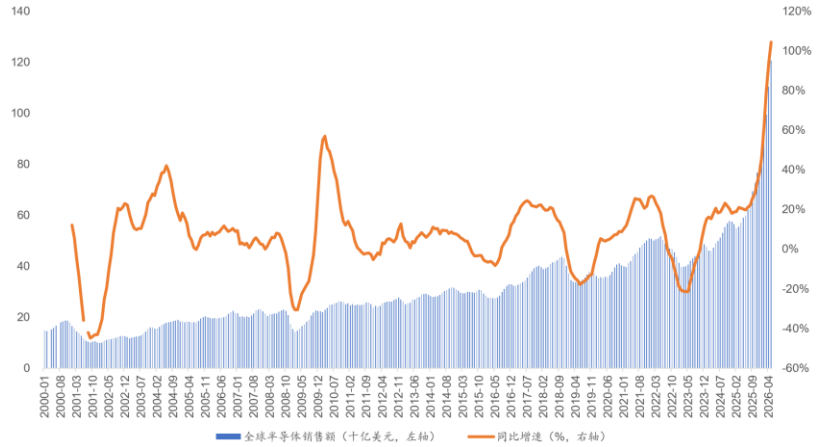
2. 全球半导体月度销售额继续同比高速增长，预计 26 年将大幅增长

2.1. 全球半导体月度销售额继续同比高速增长

2026 年 5 月全球半导体销售额同比增长 104%，环比增长 9%。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2026 年 5 月份全球半导体销售额约为 1206 亿美元，同比增长 104%，连续 31 个月实现同比增长，环比增长 9%。2026 年 5 月，从区域表现来看，同比增长上，美洲、亚太及其他地区增长超过 100%，日本增长 23.8%；环比增长上，中国市场以 10.7% 增幅居前。

仅供内部参考，请勿外传！

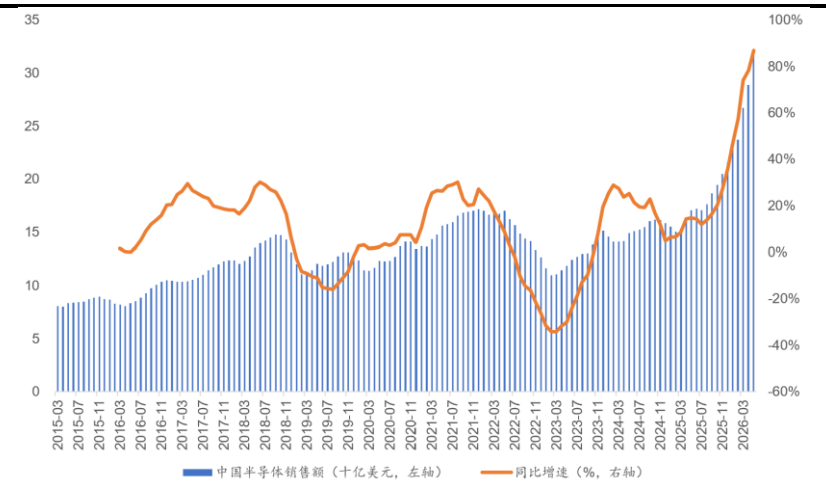
图 4：2000-2026 年全球半导体市场销售额情况



资料来源：SIA，Wind，中原证券研究所

2026 年 5 月中国半导体销售额同比增长 89%，环比增长 11%。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2026 年 5 月中国半导体行业销售额为 320 亿美元，同比增长 89%，连续 31 个月实现同比增长，环比增长 11%。

图 5：2015-2026 年中国半导体市场销售额情况

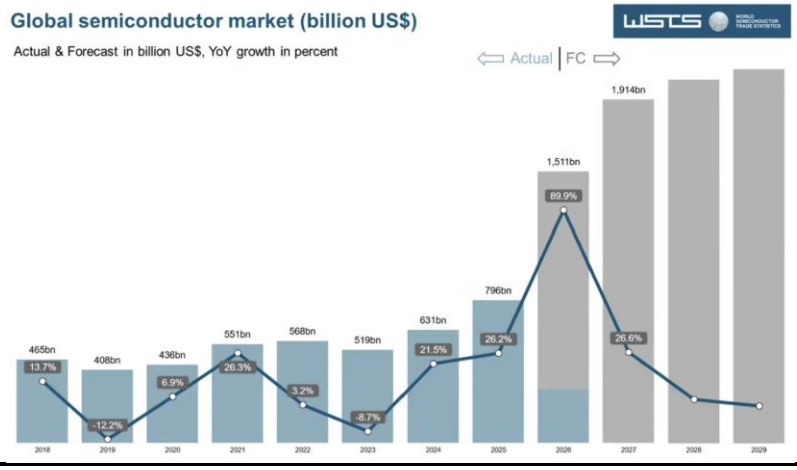


资料来源：SIA，Wind，中原证券研究所

WSTS 预计 2026 年全球半导体销售额将同比增长 89.9%。根据 WSTS 的最新预测，预计 2026 年全球半导体市场规模将达到 1.511 万亿美元，同比增幅高达 89.9%；预计半导体市场 2027 年将继续增长 26.6%，市场规模达 1.914 万亿美元。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

图 6：2018-2029 年全球半导体销售额及预测情况（十亿美元）



资料来源：WSTS，中原证券研究所

WSTS 预计 2026 年全球存储器销售额同比增长 249.5%。根据 WSTS 的最新预测，WSTS 预计存储器细分领域 2026 年销售额同比增幅将达到惊人的 249.5%，市场规模突破 8000 亿美元，一举超越 2025 年整体半导体市场规模；而逻辑芯片 2026 年也将实现 37.3%增幅；微处理器、模拟、分立、传感、光电子增幅则在 19.8%~2.7% 区间。2027 年，存储器预计将继续以 32.1% 的增速引领市场，此后是逻辑的 27.1% 和微处理器的 20.0%。

图 7：2020-2027 年全球集成电路分产品市场预测情况

	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY	2026CY	2027CY
Total IC(M$)	361,226	463,002	474,402	428,442	539,505	700,975	1,412,326	1,808,533
Analog	55,658	74,105	88,983	81,225	79,588	86,519	95,358	101,662
Micro	69,678	80,221	79,073	76,340	78,633	84,867	101,655	121,966
Logic	118,408	154,837	176,578	178,589	215,768	299,547	411,371	522,820
Memory	117,482	153,838	129,767	92,288	165,516	230,042	803,941	1,062,085

Growth Rate(%)	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY	2026CY	2027CY
Total IC(M$)	+8.4%	+28.2%	+2.5%	-9.7%	+25.9%	+29.9%	+101.5%	+28.1%
Analog	+3.2%	+33.1%	+20.1%	-8.7%	-2.0%	+8.7%	+10.2%	+6.6%
Micro	+4.9%	+15.1%	-1.4%	-3.5%	+3.0%	+7.9%	+19.8%	+20.0%
Logic	+11.1%	+30.8%	+14.0%	+1.1%	+20.8%	+38.8%	+37.3%	+27.1%
Memory	+10.4%	+30.9%	-15.6%	-28.9%	+79.3%	+39.0%	+249.5%	+32.1%

资料来源：WSTS，中原证券研究所

全球存储器厂商 26Q1 业绩表现亮眼，模拟芯片行业显著复苏。近期全球 15 大芯片厂商公布了 26Q1 季报，受益于 AI 推理对于存储用量大幅提升，推动 HBM、DDR5 及企业级 SSD 需求增长，存储器厂商三星、SK 海力士、美光、铠侠 26Q1 业绩实现同环比高速增长；目前 DRAM、NAND 供应紧张，预计 2026 年存储需求将继续快速增长。TI、NXP、ST 受益于数据中心需求加速，工业、汽车等领域需求恢复，模拟芯片行业 26Q1 显著复苏。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

表 5：全球前十五大芯片公司 26Q1 营收情况及 26 年展望

	公司	26Q1 营收（亿美元）	26Q1 同比增速	26Q1 环比增速	26Q2 环比增速指引	2026 年展望
1	英伟达	816	85%	20%	+12%	英伟达预计 26Q2 公司营收将达 910 亿美元，上下浮动 2%，中位值同比增长 95%，环比增长 12%,毛利率约为 75%。预计公司 2026 年营收将逐季度增长，并且增速将超过 Blackwell 和 Rubin 架构 5000 亿美元的营收目标。Vera CPU 将为公司打开 2000 亿美元的全新市场。
2	三星半导体	555	225%	86%	-	三星预计 26Q2 AI 基础设施扩张，存储芯片需求持续旺盛，计划交付首批 HBM4E 样品，积极把握 26H2 新款 GPU/ CPU 初期需求。预计 26H2 服务器 DRAM 与 SSD 需求预计持续强劲，智能体 AI 加速需求增长，持续提升 DDR5、SOCAMM2 等高附加值 AI 产品占比，以高性能产品主导 PCIe Gen6 企业级 SSD 市场，聚焦 KV 缓存。
3	SK 海力士	357	198%	60%	-	海力士预计 26Q2 DRAM 出货量环比增长高个位数，NAND 出货量环比增长中十位数。AI 技术正在从训练阶段向推理与 智能体阶段发展，推动存储需求从 HBM 扩展至服务器 DRAM 模块与企业级 SSD。
4	美光	239	196%	75%	+40%	美光预计 26Q2 营收为 327.5-342.5 亿美元，中位值同比+260%、环比+40%，毛利率中位值 81%。预计 2026 年 DRAM 位元出货量将增长低 20%，NAND 位元出货量将增长约 20%，预计 2026 年供应将持续紧张。预计 2026 财年资本支出将达 250 亿美元，预计 2027 年资本支出将继续增长。
5	博通	222	48%	15%	+33%	博通预计 26Q2 营收约为 294 亿美元，同比增长 84%，环比增长 33%。预计 26Q2 AI 收入为 160 亿美元，同比增长超过 200%。公司 XPU 业务态势持续强劲，六个主要客户在 XPU 上持续加大投入，预计 2027 财年 AI 芯片营收将超 1000 亿美元，预计 2027 年总交付量将接近 10 吉瓦。
6	英特尔	136	7%	-1%	+5%	英特尔预计 26Q2 营收 138-148 亿美元，中值同比+11%、环比+5%。随着 AI 工作负载从训练转向推理、智能体，CPU 在 AI 基础设施中的结构性地位更加重要。26Q1 公司签署多份 3-5 年期 LTA，包括 Google 对 Xeon 及 ASIC 的量价锁定； NVIDIA DGX Rubin NVL8 系统选择 Xeon 6 为主 CPU。
7	AMD	103	38%	0%	+9%	AMD 预计 26Q2 营收为 109-115 亿美元，中位值同比+46%、环比+9%，毛利率约为 56%。AMD CEO 苏姿丰预计 2030 年服务器 CPU 可寻址空间从 600 亿美元上修至 1200 亿美元，年复合增长率超 35%，CPU/GPU 配比从传统 1:4/1:8 向接近 1:1 转变，CPU 成为 AI 基建的核心增量。
8	高通（IC）	91	-4%	-14%	-14%	高通 26Q1 汽车业务强劲，但手机与物联网业务疲软拖累整体表现。预计 26Q2 QCT 芯片业务营收 79–85 亿美元，中位值环比下降-14%，主要由于中国手机厂商去库存导致手机芯片需求低迷。
9	铠侠	62	-	84%	+75%	铠侠预计 26Q2 营收为 1.75 万亿日元，环比增长 74.5%。AI 数据中心 NAND 需求是核心驱动力，2026 财年产能已基本售罄，供需紧张支撑高位价格。NAND 市场已脱离传统周期性，转向更稳定的增长轨道。
10	TI	48	19%	9%	+8%	TI 预计 26Q2 营收 50-54 亿美元，中值同比+17%、环比+8%。26Q1 数据中心业务营收同比增长 90%、环比增长超过 25%，工业业务营收同比增长超过 30%、环比增长超过 20%，汽车业务营收实现同比中个位数增长；AI 数据中心是公司当前最强增长引擎，2025 年占比已达 9%，2026 年有望进一步提升；工业与汽车韧性强。
11	联发科	47	-3%	-2%	-3%	联发科预计 26Q2 营收为 1402-1492 亿元新台币，中位值同比+12%、环比-3%，毛利率为 46%；预计 26Q2 主要受益于 Smart Edge 动能强劲，抵消智能手机需求疲弱；预计 2026 年 ASIC 营收达 20 亿美元，2027 年达 70-120 亿。
12	英飞凌	44	6%	4%	+8%	英飞凌预计 26Q2 营收约 41 亿欧元，环比+8%。展望

仅供内部参考，请勿外传！

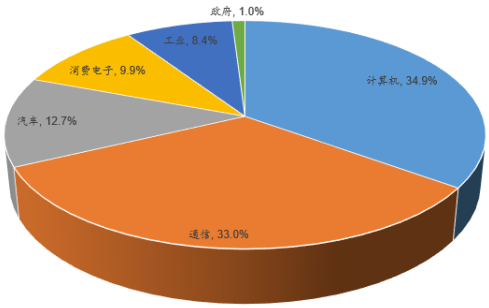
						2026 财年，AI 需求确定性高，工业市场开始恢复，汽车风险可控，全年指引从温和增长上调至显著增长，收入目标突破 160 亿欧元。
13	ADI	36	37%	15%	+8%	ADI 预计 26Q2 营收 38-40 亿美元，中值同比+48%、环比+8%。公司工业、汽车和通信业务均获得创纪录的订单量，这些积极的需求信号将推动 26Q2 持续强劲增长。AI 基础设施投资将是未来数年增长的核心驱动力。
14	恩智浦	32	+12%	-5%	+8%	恩智浦预计 26Q2 营收为 34.5 亿美元，同比+18%、环比-6%，毛利率为 57.6%。预计 26Q2 汽车业务环比高个位数增长；工业与物联网业务环比高十位数增长；移动业务环比中双位数下滑；通信基础设施业务环比中十位数增长。
15	意法半导体	31	23%	-7%	11%	ST 预计 26Q2 营收中值为 34.5 亿美元，中值环比+11%；毛利率中值约为 34.8%。26Q1 通信设备与计算机外设业务营收同比+41%，工业业务营收同比+26%，个人电子产品营收同比+21%，汽车业务营收同比+15%。预计 2026 年营收实现两位数增长。

资料来源：各公司公告，中原证券研究所

2.2. 2026 年全球 AI 眼镜出货量有望快速增长，AI 算力硬件基础设施需求旺盛

全球半导体下游需求呈现结构性特征，消费类需求占比较高。根据 SIA 的数据，2024 年全球半导体下游应用领域中计算机占比 34.9%、通信占比 33.0%、汽车占比 12.7%、消费电子占比 9.9%、工业占比 8.4%、政府占比 1%。消费类下游占比较高，目前 AI 算力硬件需求持续旺盛，工业市场需求开始复苏。

图 8：2024 年全球半导体下游应用领域占比情况



资料来源：SIA，中原证券研究所

2.2.1. 全球智能手机季度出货量小幅增长，预计 2026 年全球智能手机市场将有所承压

26Q1 全球智能手机出货量同比增长 1%。根据 Omdia 的数据，2026 年第一季度，全球智能手机出货量同比增长 1%，市场表现超出预期。由于渠道商提前备货行为在短期内支撑了部分出货量，这一增长尚未完全体现出供应端成本上涨带来的全部影响。内存与存储成本已经开始大幅上涨，但厂商尚未在所有市场全面上调终端零售价。26Q1 内存（DRAM）与闪存（NAND）价格环比上涨约 90%，预计第二季度将继续上涨 30%，这会显著推高物料成本。2026 年二季度或将开启渠道库存调整阶段，但行业复苏节奏不均衡，整体回暖力度将弱于此前预期。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

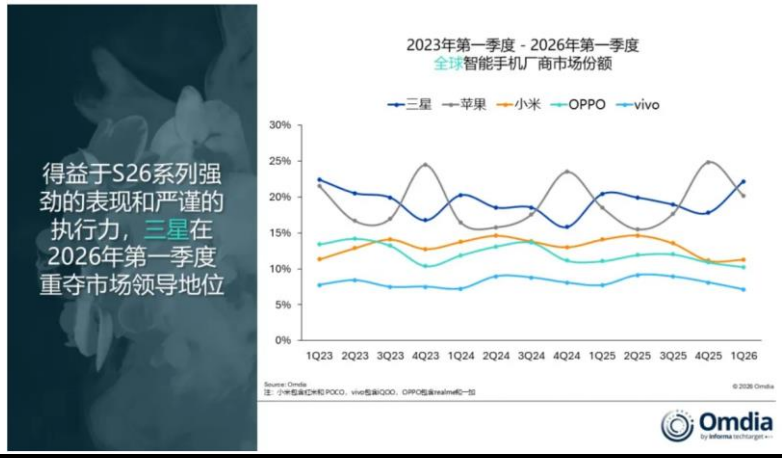
图 9：22Q1-26Q1 全球智能手机出货量情况



资料来源：Omdia，中原证券研究所

26Q1 三星、苹果、小米、OPPO、vivo 市场份额位列前五位。根据 Omdia 的数据，2026 年第一季度，三星重夺市场榜首位置，尽管发布延期影响了其中端机型的迭代节奏，其旗舰机型需求表现依然坚挺，并且 Galaxy S26 系列全球预售量较 Galaxy S25 系列增长超 10%；苹果同样实现季度强势表现，iPhone 17 系列定价稳定、需求稳健，即便部分区域出现供应中断也未对总出货量产生明显影响；除前两大厂商外，多数安卓品牌在出货量与利润率两端均面临挑战，并纷纷通过精简产品线、选择性发布新品、定价策略等更趋的审慎方式应对；同时华为凭借具备竞争力的定价在国内市场表现强劲，荣耀持续推进海外扩张，二者均实现了市场份额提升。

图 10：23Q1-26Q1 全球智能手机厂商市场份额情况

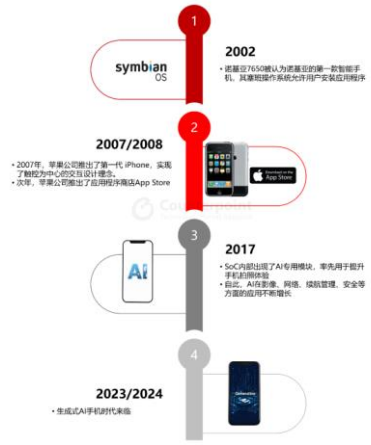


受益于 AI 大模型的赋能，智能手机将迎来 AI 新时代。通过 AI 技术赋能智能手机可以追溯至 2017 年，安卓厂商开始在其 SoC 平台中加入独立的 AI 计算单元，用于运行和影像增强相关的深度学习模型，随后 AI 技术逐渐被手机厂商用于更多方面，如强化安全、优化续航、提升网络性能等，但计算、摄影一直是其最主要的应用领域，直到大模型被装进智能手机，手机 AI 应用从中小模型时代跨越至大模型时代。有了大模型的加持，在人机交互层面，新的多模态交互将取代传统的触控屏交互，用户可以更自然的与手机沟通；多模态输入和输出能力相结合，可以极大强化智能手机的生产力工具属性，既可以基于多种形式的输入信息，生成用户需要的图表、文本、音乐、图片甚至是视频，也可以对输入的图片、视频进行编辑。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

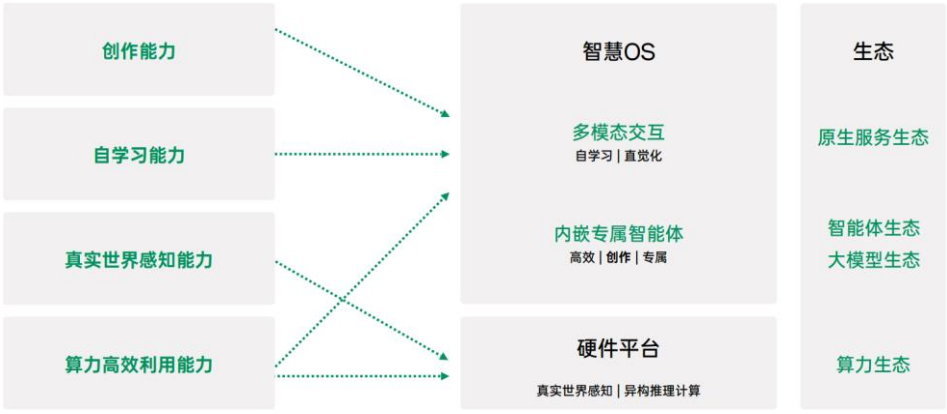
图 11：手机智能化演进路线图



资料来源：生成式 AI 手机产业白皮书（Counterpoint，联发科等），中原证券研究所

AI 手机可以通过端侧部署 AI 大模型实现多模态内容生成、情境感知，能更自然的进行交互，并内嵌专属智能体。AI 手机应具有创作能力、自学习能力、真实世界感知能力、算力高效利用能力。

图 12：AI 手机带来手机全栈革新和生态重构



资料来源：AI 手机白皮书（IDC，OPPO），中原证券研究所

生成式 AI 将成为智能手机厂商的重要战略，行业领导者引领 AI 技术。随着三星发布全新的 Galaxy S24 智能手机，三星将生成式 AI 作为长期的产品策略，同时中国厂商小米、vivo、OPPO 和荣耀等也已发布具备生成式 AI 能力的旗舰机型。AI 逐步从最初的产品层面的差异化上升至运营及公司层面的整体战略，各智能手机厂商均涉及其中。苹果、谷歌和三星等全球主要厂商以及荣耀、OPPO、小米和 vivo 等中国领先厂商都走在将生成式 AI 功能集成到其设备的前列；其战略各不相同，从开发专用 AI 芯片到加强利用 AI 的生态系统集成来提升用户体验。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

图 13：AI 手机生态系统及主要参与者情况



资料来源：Canalys，中原证券研究所

高通、联发科不断迭代支持端侧 AI 大模型手机的 SoC 芯片，NPU 算力不断提升。2025 年 9 月 25 日，高通正式发布新一代旗舰芯片骁龙 8 Elite Gen 5，延续 2+6 核心架构，两个 Prime 核心频率提升至 4.6GHz，六个性能核心运行于 3.62GHz；比前代产品，CPU 性能提升 20%，能效提升 35%，整体功耗降低 16%；图形处理方面，新一代 Adreno GPU 采用切片式架构，整体 GPU 性能提升 23%，功耗降低 20%；AI 性能显著增强，Hexagon NPU 速度提升 37%，支持 INT2 精度量化，可在设备端运行更复杂的大语言模型。2025 年 9 月 22 日，联发科正式发布天玑 9500 旗舰手机处理器，天玑 9500 全大核 CPU 架构包含 1 个主频高达 4.21GHz 的 C1-Ultra 超大核、3 个 C1-Premium 超大核和 4 个 C1-Pro 大核，物体侦测运算性能提升 57%、运行编解码模型功耗下降 50%；搭载新一代旗舰 GPU G1-Ultra，其峰值性能相较上一代提升 33%，功耗相较上一代峰值性能下降低 42%，光线追踪渲染性能较上一代提升 119%；集成全新超性能和超能效双 NPU，超性能 NPU 990 峰值性能相较上一代提升 111%，在大语言模型摘要输出能力、多模态理解能力皆有大幅跃进，并率先实现 4K 高清画质文生图，同时 NPU 990 相较上一代在峰值性能下的功耗降低 56%。

表 6：全球部分处理器厂商发布的支持端侧 AI 大模型手机的 SoC 芯片情况

厂商	处理器	发布时间	CPU	GPU	NPU AI 算力	存储器	制程
高通	骁龙 8 Gen 3	2023.10	骁龙 8 Gen 3	Adreno750 GPU	支持 100 亿参数的 AI 大模型	LPDDR5X	4nm
高通	骁龙 8 Elite	2024.10	Oryon CPU	Adreno 830	80 TOPS	LPDDR5X	3nm
高通	骁龙 8 Elite Gen 5	2025.9	Oryon CPU，8 核心（2+6）	Adreno 840	-	LPDDR5X	3nm
联发科技	天玑 9300	2023.11	8 核心，4 个 Cortex-X4、4 个 Cortex-A720，最高主频 5.2GHz	12 核 Arm Immortalis-G720 MC12 GPU	支持 330 亿参数的 AI 大模型	LPDDR5T	4nm
联发科技	天玑 9400	2024.9	8 核心，1 个 Cortex-X925，3 个 Cortex-X4、4 个 Cortex-A720	12 核 Arm Immortalis-G925 GPU	MediaTek NPU 890	LPDDR5X	3nm
联发科技	天玑 9500	2025.9	8 核心，1 个 C1-Ultra 超大核、3 个 C1-Premium 超大核，4 个 C1-Pro 大核	G1-Ultra	集成全新超性能和超能效双 NPU，NPU 990	LPDDR5X	3nm
苹果	A18	2024.9	6 核心，2 个性能核心和 4 个效率核心，主	5 核 GPU	35 TOPS	LPDDR5X	3nm

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

			频分别为 4.05GHz 和 2.42GHz				
苹果	A19/Pro	2025.9	6 核心	6 核 GPU	-	LPDDR5X	3nm

资料来源：各公司官网，中原证券研究所

手机厂商持续迭代 AI 手机。随着三星发布全新的 Galaxy S24 智能手机，三星将生成式 AI 作为长期的产品策略，同时中国厂商华为、小米、vivo、OPPO 和荣耀等也陆续发布并持续迭代 AI 手机。目前安卓手机厂商旗舰机型的 AI 功能主要支持通话实时翻译、通话及会议摘要、语音识别与文本生成、AI 写作、AI 修图等，AI 功能仍为基础性应用。

表 7：全球部分智能手机厂商旗舰 AI 手机布局情况

厂商	型号	发布时间	处理器	存储器	大模型	参数量	AI 功能
苹果	iPhone16/ Pro/ Max	2024.9	苹果 A18/ Pro	8GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	自有模型及第三方模型	-	支持 Apple Intelligence。
苹果	iPhone17/ Air / Pro/ Max	2025.9	苹果 A19/ Pro	12GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	自有模型及第三方模型	-	支持 Apple Intelligence。
三星	Galaxy S24/ Plus/Ultra	2024.1	骁龙 8 Gen 3	12GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	谷歌 Gemini Nano	1.8B/3.25B	支持通话实时翻译、写作助手、转录助手、智能修图、利用 AI 改善成像效果的 AI 图像处理器等。
三星	Galaxy S25/ Plus/Ultra	2025.1	骁龙 8 至尊版	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	谷歌 Gemini Nano，DeepSeek-R1	-	支持深度思考与联网搜索；搭载升级的 Galaxy AI，支持即圈即搜、写作助手和更为智能的翻译功能，支持 AI 影像优化等。
华为	Mate70/ Pro	2024.11	麒麟 9010/9020	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	支持 AI 运动轨迹、AI 主角时刻、AI 时空穿越、AI 智控键、AI 隔空传送、AI 通话摘要、AI 消息随身、AI 降噪通话、AI 静谧通话。
华为	Mate80/ Pro	2025.11	麒麟 9020/9030	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	支持全新小艺智能助手，支持自主学习与技能生成、任务自动化、购物场景优化、系统级整合等功能；支持 AI 魔法系列的图像视频创作等。
小米	小米 15	2024.10	骁龙 8 Elite	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	小米 MiLM2	0.3B-30B	支持超级小爱助手、AI 写作、AI 字幕、AI 妙画、语音识别与文本生成、全局实时翻译等。
小米	小米 15 Ultra	2025.2	骁龙 8 至尊版	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	支持 AI 影像系统，可实现 AI 动态人像壁纸、AI 融合变焦、智能拍摄优化功能；支持 AI 绘画与文本生成功能、AI 助手与语音识别等。
小米	小米 17/ Pro/ Max	2025.9	第五代骁龙 8 至尊版	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	以“AI 生态融合”为核心定位，依托澎湃 OS 3.0 与硬件级 AI 算力支撑，构建了覆盖交互、影像、创作、跨设备协同等多场景的 AI 功能体系。
OPPO	Find X8	2024.10	天玑 9400	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	OPPO AndesGPT	7B	支持 SenseNow 智慧框架、AI 私密计算云、AI 修图功能、AI 超清像素、AI 千里长

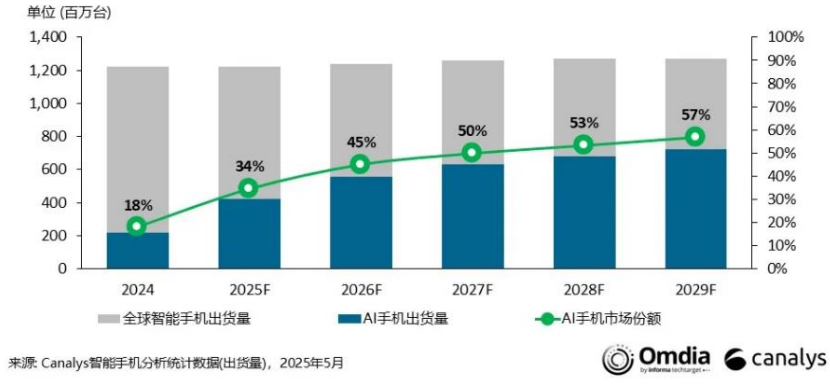
仅供内部参考，请勿外传！

							焦、全局语音摘要功能等。
OPPO	Find X9	2025.10	天玑 9500	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	小布 AI 智能助手支持一键闪记、主动智能建议、系统级 AI 集成等；影像 AI 功能支持 AI 人像补光、AI 灵感成片、Live 图 AI 消除等。
vivo	X200	2024.10	天玑 9400	16GB LPDDR5X、最高 1TB 存储空间	vivo 蓝心大模型	1B/7B	支持超能问答、超能创作、超能搜索、超能管理、超能交互、原子岛、小 V 电话助手、小 V 写作等。
vivo	X300	2025.10	天玑 9500	16GB LPDDR5X、最高 1TB 存储空间	-	-	影像 AI 功能包括 AI 电影分镜、灵动人像算法、AI 定制美颜、Live Photo 路人消除等，系统 AI 功能包括小 V 圈搜 2.0 等。
荣耀	Magic 7/pro	2024.10	骁龙 8 Elite	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	光影人像大模型/荣耀魔法大模型	1.3B/7B	支持 AI 智能体验，包括一键生成会议纪要、AI 辅助高效阅读、AI 辅助高效写作等，以及 AI 换脸检测、AI 魔法修图等。
谷歌	Pixel 9/Pro	2024.8	谷歌 Tensor G4	16GB LPDDR5X、最高 1TB 存储空间	谷歌 Gemini Nano	1.8B/3.25B	支持 Add Me 功能、Pixel Studio、Pixel Screenshots、魔法编辑器、Gemini Live 语音助手、询问此屏幕/视频等。

资料来源：各公司官网，中原证券研究所

Canalys 预计 2026 年 AI 手机渗透率将达到 45%，端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一步助推 AI 手机向中端价位段渗透。2025 年芯片厂商发布的新款次旗舰 SoC，如 Snapdragon 8s Gen4, Dimensity 9400e 已经具备了流畅运行端侧大模型的能力，Deepseek 的出现也在很大程度上降低了大模型对于芯片算力的开销，在这两大因素的共同作用下，2025-2026 年 AI 手机仍预计会保持高速渗透的趋势。根据 Canalys 的预测，2024 年全球智能手机出货量中 18%为 AI 手机，预计 2025 年渗透率将快速提升至 34%，预计 2026 年将达到 45%。

图 14：2024-2029 年全球 AI 手机出货量及预测情况



资料来源：Canalys，中原证券研究所

2.2.2. 全球 PC 季度出货量继续同比增长，预计 2026 年全球 PC 出货量大幅下降

全球 PC 出货量 26Q1 同比增长 3.2%。根据 Omdia 的数据，2026 年第一季度，全球台

仅供内部参考，请勿外传！

式机、笔记本和工作站的总出货量同比增长 3.2%，达到 6480 万台，其中，笔记本（含移动工作站）出货量同比小幅增长 2.6%，达 5080 万台；台式机（含台式工作站）表现略好，同比增长 5.4%，达到 1400 万台；增长动力主要来自于厂商和渠道合作伙伴提前拉动订单，以应对普遍预期的组件成本上涨，同时 Windows 10 更换周期仍在推动企业更新预算，以及春季期间 Windows OEM 和苹果的产品发布较为集中。Omdia 首席分析师 Ben Yeh 表示：“随着供应链压力持续加剧，第一季度温和的增长很可能成为全年表现的高点；从第二季度开始，内存和存储成本预计将比此前预期更快、更大幅度上涨，这将压缩 PC 厂商的毛利率，并迫使厂商将部分成本转嫁给渠道合作伙伴和终端客户；与此同时，AI 数据中心的大规模建设正在挤占面向消费市场的内存和存储供应。

图 15：23Q1-26Q1 年全球 PC 季度出货量情况



资料来源：Omdia，中原证券研究所

26Q1 全球 PC 市场厂商前五名分别为联想、惠普、戴尔、苹果和华硕。根据 Omdia 的数据，2026 年第一季度，联想继续稳居全球 PC 市场第一，并进一步扩大市场份额；其出货量达到 1650 万台，同比增长 8.7%，市场份额超过 25%；惠普仍位居第二，但由于在欧洲和美国市场表现疲软，出货量同比下降 4.9%，降至 1210 万台；戴尔延续了 2025 年第四季度以来的强劲势头，出货量同比增长 7.8%，达到 1030 万台；主要得益于 MacBook Air 销售表现稳健以及 MacBook Neo 的初期铺货，苹果市场份额达到 11%，出货量同比增长 5.4%；华硕继续保持两位数出货增长，出货量提升至 460 万台，市场份额达到 7.1%。

表 8：26Q1 全球 PC 厂商市场份额情况

公司	26Q1 出货量（百万台）	26Q1 市场份额（%）	25Q1 出货量（百万台）	25Q1 市场份额（%）	26Q1 同比增速（%）
联想	16.5	25.5	15.2	24.2	8.7
惠普	12.1	18.7	12.8	20.3	-4.9
戴尔	10.3	15.9	9.5	15.2	7.8
苹果	7.1	11.0	6.8	10.7	5.4
华硕	4.6	7.1	4.0	6.4	15.1
其他	14.1	21.8	14.6	23.2	-2.9
合计	64.8	100	62.8	100	3.2

资料来源：Omdia，中原证券研究所

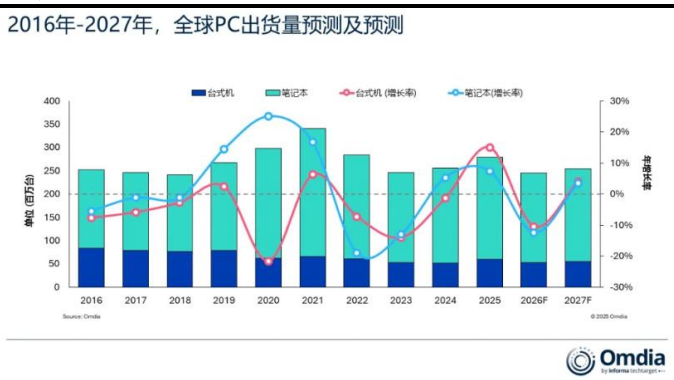
Omdia 预计 2026 年全球 PC 出货量下降 12%。根据 Omdia 的最新预测，2026 年全球台式机、笔记本及工作站出货量预计下降 12%，至 2.45 亿台；这一预测基于内存与存储价格的急剧上涨——特别是预计 2026 年第一季度将至少上涨 60%；预计全年剩余季度仍将面临进

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

一步的价格上涨压力，但后续涨幅可能更加温和；自 2025 年第一季度以来，主流内存与存储配置的成本已上涨 90 至 165 美元，对 PC 厂商造成重大财务压力，迫使其减少促销、提高产品售价并调整配置；各类 PC 产品受影响的程度预计大体一致，台式机出货量预计下降 10%至 5320 万台，笔记本出货量预计下降 12%至 1.922 亿台。

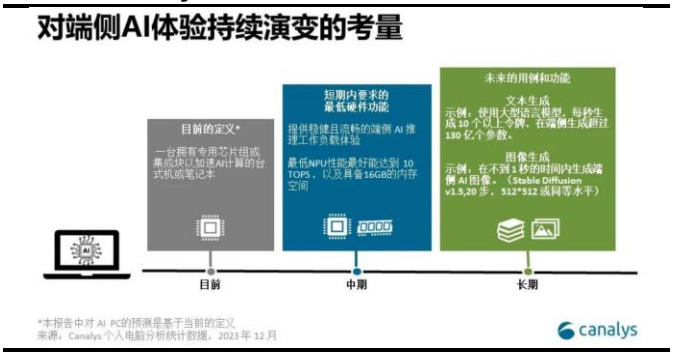
图 16：2016-2027 年全球 PC 出货量及预测情况



资料来源：Omdia，中原证券研究所

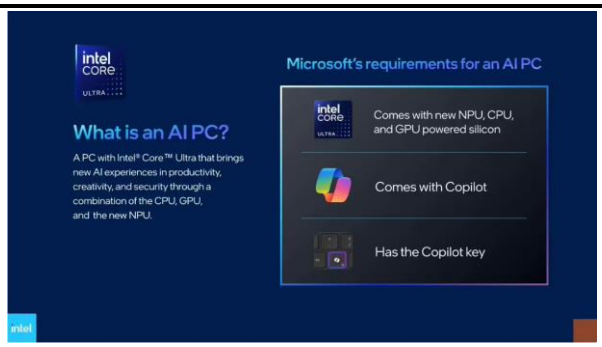
AI PC 是端侧 AI 落地的重要应用场景，将推动 PC 产业生态加速迭代。具备 AI 功能的个人电脑（AI PC）的问世有望重振市场并改变用户体验，将专用的 AI 加速硬件集成到 PC 中，可以在效率、生产力、协作和创造力方面实现惊人的创新。Canalys 提出 AI PC 需要具备专用芯片组/块以承载端侧的 AI 运行负载。微软和英特尔联合提出 AI PC 的定义，即 AI PC 需要配备 NPU、CPU 和 GPU，并支持微软的 Copilot，且键盘上直接配有 Copilot 物理按键（该键取代了键盘右侧第二个 Windows 键）。AI PC 是终端、边缘计算和云技术的颠覆性混合体，它不仅重新定义生产力，也将推动 PC 产业生态加速迭代。

图 17：Canalys 对 AI PC 的定义及未来演变的考量



资料来源：Canalys，中原证券研究所

图 18：微软和英特尔对 AI PC 的定义



资料来源：微软，英特尔，IT 之家，中原证券研究所

英特尔、AMD 等芯片厂商持续迭代适用于 AI PC 的处理器芯片，NPU 算力不断提升。2024 年 9 月 4 日，英特尔发布超高能效的 x86 处理器家族——英特尔酷睿 Ultra 200V 系列处理器，CPU、NPU 和 GPU 的整体平台算力高达 120 TOPS，在实现跨模型和引擎的同时提供极具兼容和性能的 AI 体验，整体功耗降低了 50%，使搭载该处理器为 AI PC 带来超前的低功耗表现。2024 年 6 月 4 日，AMD 为下一代 AI PC 推出锐龙 AI 300 系列处理器，采用全新的“Zen 5”架构，配备高达 12 颗高性能 CPU 核心和 24 个线程；采用基于全新 AMD XDNA 2 架构的专用 AI 引擎，NPU 拥有 50 TOPS 的 AI 处理能力；采用全新的 AMD RDNA 3.5 图形架构，配备最新的 AMD Radeon 800M 系列显卡，带来流畅的帧速率和 3A 游戏体验。英特

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

尔、AMD、高通和苹果等芯片厂商持续迭代适用于 AI PC 的处理器芯片，联想、惠普等 PC 厂商陆续发布 AI PC 新品。

表 8：全球主要处理器厂商发布的适用于 AI PC 处理器情况

厂商	处理器	发布时间	CPU	GPU	NPU AI 算力	存储器	制程
英特尔	酷睿 Ultra 9	2023.12	16 核心（6+8+2）/22 线程，最高主频 5.1GHz	Intel Arc GPU，8 个 Xe 核显	34TOPS	支持最多 64GB 的 LPDDR5/5X-7467 和 96GB DDR5-5600	Intel 4
英特尔	酷睿 Ultra 200V	2024.9	8 核 8 线程，最高主频 5.1GHz	Intel Arc 100V GPU	NPU 算力最高 48TOPS，整体算力 120TOPS	支持最大 32GB 的 LPDDR5X-8533	3nm
AMD	锐龙 8040	2023.12	Zen 4 架构，8 核心/16 线程，最高主频 5.2GHz	RDNA 3 架构，12 个计算单元	NPU 算力 16TOPS，整体算力 39TOPS	-	4nm
AMD	锐龙 AI 300	2024.6	Zen 5 架构，12 核心/24 线程，最高主频 5.1GHz	RDNA 3.5 架构，16 个计算单元	50 TOPS	-	4nm
高通	骁龙 X Elite	2023.10	Oryon CPU，12 核，最高主频 3.8GHz	Adreno GPU，算力达 4.6TFlops	NPU 算力 45TOPS，整体算力 75TOPS	支持 LPDDR5X 8533MHz，最大容量 64GB	4nm
苹果	M3	2023.10	8 个 CPU 核心	10 个 GPU 核心	18TOPS	支持内存容量最高达 128GB	3nm
苹果	M4	2024.5	10 个 CPU 核心	10 个 GPU 核心	38TOPS	支持内存容量最高达 128GB	3nm

资料来源：各公司官网，中关村在线，IT 之家，中原证券研究所

联想、惠普等 PC 厂商陆续发布 AI PC 新品。AI PC 是终端、边缘计算和云技术的颠覆性混合体，它不仅重新定义生产力，也将推动 PC 产业生态加速迭代。头部 PC 厂商视 AI PC 为重要的创新机会，PC 行业迎来 iPhone 时刻。随着英特尔、AMD 等芯片厂商陆续推出适用于 AI PC 的计算芯片，以及 Windows 向 Windows11 过渡，头部 PC 厂商联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、华硕、三星、荣耀、华为等都陆续推出全新的 AI PC 产品。

表 9：全球部分 PC 厂商 AI PC 布局情况

厂商	型号	处理器	内存	硬盘	软件
联想	Thinkpad X1 Carbon AI	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5x 6400Mhz	2TB PCIe NVMe Gen4 高速固态硬盘	内置了全新的 AI 智能会议助手，可以通过 AI 完成会议邮件撰写、发送会议邀请，撰写会议纪要等工作，实现 AI 智能降噪等；实现一秒之内完成图片创作。
	小新 Pro AI 超能本 2024	英特尔酷睿 Ultra 9	32GB LPDDR5x 7467MT/s	1TB PCIe 4.0 高性能固态硬盘	通过智能语音助手、智能图像识别等技术，为用户提供更便捷、高效的使用体验；支持智能家居控制，可以通过语音指令实现对家中各种设备的远程控制。
惠普	星 Book Pro 14	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5X	1TB PCIe 4.0 固态硬盘	支持智能语音助手，支持实时翻译，更精准，可收录来自系统声音，支持中英文互译，可译文或原译文同时显示字幕。
	Spectre x360 商务本	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5x 7467Mhz	2TB PCIe 4.0 高性能固态硬盘	支持 AI 智能降噪功能，智能追焦取景，AI 智能字幕翻译，支持语音输入和会议笔记功能，能够实时记录语音并翻译，支持中英/英中互译。
戴尔	灵越 16Plus	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5X	1TB PCIe 4.0 固态硬盘	与 100 多个 AI APP 加速合作；AI 智能降噪、AI 眼神锁定和 AI 背景虚化等智能功能的全面覆盖。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

	XPS 16	英特尔酷睿 Ultra 9	64GB LPDDR5X	2TB PCIe 4.0 固态硬盘	搭载 Windows 11 系统，支持 200 亿参数大模型运行，能够实现本地生图。
苹果	MacBook Air	M3	24GB 100GB/s	2TB 固态硬盘	实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等。
宏基	非凡 Go 14	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5X	1TB PCIe 4.0 高速固态硬盘	支持智能视频会议,自动取景、眼神接触、物理防窥、AI 降噪。
华硕	灵耀 14 2024	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5x	1TB PCIe 4.0 高速固态硬盘	支持 200 亿参数的大模型，即使不联网也能实现问答、文本创作、摘要生成、编程、翻译等多种功能。
三星	Galaxy Book 4 Ultra	英特尔酷睿 Ultra 9	64GB LPDDR5X	2TB PCIe 4.0 固态硬盘	与 100 多个软件供应商加速合作，支持 Galaxy AI 功能，支持智能搜索和翻译，利用 AI 技术对照片进行智能编辑。
荣耀	MagicBook Pro 16	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5X	1TB PCIe 4.0 固态硬盘	配备 YOYO AI 超级助理凭借其先进的 AI 语义理解能力，实现了智慧搜索、文档总结以及智能推荐等多项功能。
华为	Matebook X Pro	英特尔酷睿 Ultra 9	32GB LPDDR5X	2TB PCIe 4.0 固态硬盘	内置华为盘古大模型，搭载 AI 空间功能，支持 100+个智能体，为用户提供从代码编写、文档处理到创意设计、信息检索等；能从音视频或实时纪要的海量信息中，快速精准地提炼关键点，生成摘要；支持 AI 字幕，实时翻译等功能。

资料来源：各公司官网，中原证券研究所

预计 AI PC 渗透率将持续快速提升。根据 Canalys 的数据，2024 年第四季度，AI PC 出货量达到 1540 万台，占季度 PC 总出货量的 23%；2024 年 AI PC 占 PC 总出货量的 17%；其中苹果以 54%的市场份额领跑，联想和惠普各占 12%。受 Windows 10 服务停止带来的换机潮，预计 AI PC 的市场渗透率将在 2025 年继续提升。展望未来，受商用需求的推动，PC 市场将加速增长，企业正为 Windows 10 系统结束做准备；目前 PC 市场正致力于将 AI PC 打造成明星类别，根据 Canalys 的预测，预计 2025 年 AI PC 将占全球 PC 出货量的 35%。

图 19：23Q4-24Q4 全球 AI PC 出货量情况



资料来源：Canalys，中原证券研究所

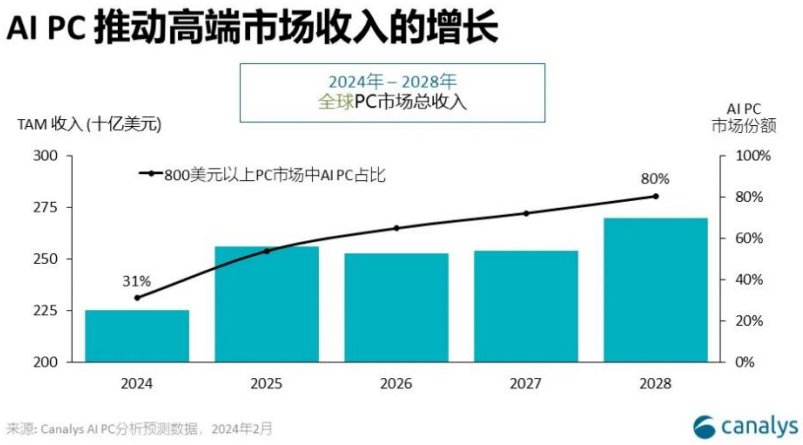
图 20：24Q1-25Q4 全球 PC 及 AI PC 出货量及预测



资料来源：Canalys，中原证券研究所

AI PC 有望推动高端 PC 市场收入增长。AI PC 集成了专用于 AI 的加速器，将释放出高生产力、个性化及能效方面的新功能，颠覆整个 PC 市场，并为厂商及其合作伙伴带来显著的价值收益。根据 Canalys 的预测，与未集成 NPU 的传统 PC 相比，AI PC 将溢价 10%-15%；随着采用率的激增，到 2025 年底，价格在 800 美元及以上的 PC 将有一半以上是 AI PC，到 2028 年，这一比例将增至 80%以上。因此，800 美元及以上的 PC 出货量将在短短四年内增长到市场的一半以上，这将有助于推动 PC 出货的整体价值从 2024 年的 2250 亿美元增长到 2028 年的 2700 亿美元以上。

图 21：2024-2028 年全球 PC 市场总收入预测情况



资料来源：Canalys，中原证券研究所

2.2.3. AI 眼镜是端侧 AI 最佳硬件载体之一，2026 年全球 AI 眼镜出货量有望快速增长

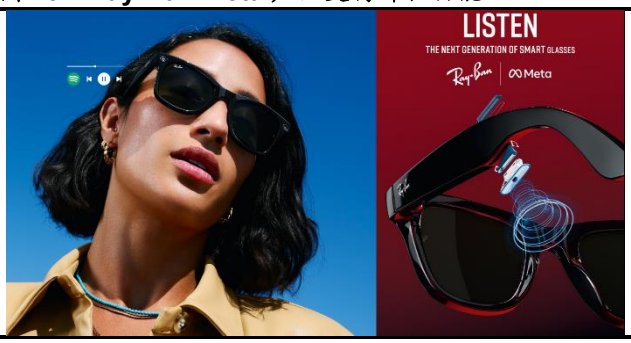
AI 眼镜是端侧 AI 最佳硬件载体之一。嘴巴、耳朵和眼睛是人体三大重要感官器官，嘴巴是语言输出器官，耳朵是语音接受的器官，眼睛则是人类最重要的信息摄入器官，人 80%的信息来源于视觉。眼镜是最靠近人体三大重要感官的穿戴设备，是端侧 AI 最佳硬件载体之一，可以非常直接和自然的实现声音、语言、视觉的输入和输出。

图 22：Ray-Ban Meta 产品示意图



资料来源：腾讯，中原证券研究所

图 23：Ray-Ban Meta 产品支持耳机功能



资料来源：腾讯，中原证券研究所

AI 眼镜是在普通眼镜的基础上，增加 AI 功能，拍照 AI 眼镜为当前主流形态。AI 眼镜的产品形态包括音频 AI 眼镜、拍照 AI 眼镜、AR+AI 眼镜；传统蓝牙音频眼镜接入 AI 大模型，是 AI 眼镜的基础形态，AI 大模型通过语音交互方式提供基础的智能服务；拍照 AI 眼镜是在音频 AI 眼镜的基础上增加摄像头，AI 大模型可通过摄像头感知周边环境，提供与当下环境具备交互能力的智能服务；AR+AI 眼镜是具备 AR 显示功能、并且接入大模型的眼镜，部分眼镜具备拍照、空间定位等多模态感知能力，AI 大模型可通过 AR 显示实现实时信息输出，实现更简便的信息交互。根据 wellsenn XR 的数据，2024 年全球 AI 眼镜销量中 94%为拍照 AI 眼镜，4%为 AR+AI 眼镜，2%为音频 AI 眼镜。

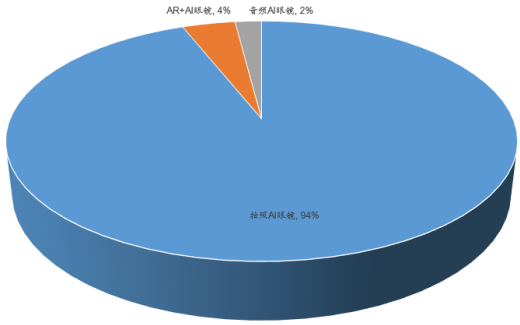
仅供内部参考，请勿外传！

图 24：AI 眼镜产品形态分类情况



资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

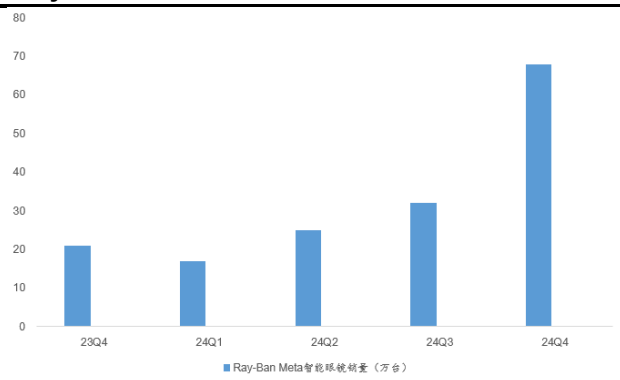
图 25：拍照 AI 眼镜为当前主流形态



资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

Ray-Ban Meta 发布后热销，带动大量厂商加速进入 AI 眼镜市场。2023 年 9 月，Meta 联合雷朋推出 Ray-Ban Meta 智能眼镜，Ray-Ban Meta 为眼镜增加了摄像、耳机，以及 AI 功能。用户可以通过语音与 Meta AI 进行互动，获取各种信息和服务；支持英语、西班牙语、意大利语、法语和德语之间的互译，能够翻译所拍摄到的标识和文字，并以对应的语言念出来。根据 wellsenn XR 的数据，2024 年 Ray-Ban Meta 眼镜出货量达 142 万台。Ray-Ban Meta 智能眼镜发布后热销,带动百度、华为、小米、三星、雷鸟等厂商加速进入 AI 眼镜市场。

图 26：23Q4-24Q4 Ray-Ban Meta 眼镜出货量情况



资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

百度发布全球首款搭载中文大模型的原生 AI 眼镜。2024 年 11 月 12 日，百度正式发布小度 AI 眼镜，称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生 AI 眼镜”。小度 AI 眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。小度 AI 眼镜支持文心大模型，对接百度地图、搜索、百科等百度应用生态。

图 27：小度 AI 眼镜产品示意图



资料来源：百度，IT 之家，中原证券研究所

图 28：小度 AI 眼镜产品配置及功能情况



资料来源：百度，IT 之家，中原证券研究所

仅供内部参考，请勿外传！

华为发布智能眼镜 2——钛空圆框光学镜。2025 年 4 月 16 日消息，华为正式发布智能眼镜 2——钛空圆框光学镜；华为智能眼镜 2 设计整体风格时尚，眼镜的“鸢尾”雕花设计精致高雅，钛金属镜框不仅轻巧坚固，还经过 33 道工序精雕细琢，确保了产品的耐用性和美观性；华为智能眼镜 2 配备小艺翻译、头部控制等功能，支持面对面翻译、同声传译、全天候智慧播报，续航为 11 小时，售价 2299 元。

图 29：华为智能眼镜 2 产品示意图



资料来源：华为官网，中原证券研究所

图 30：华为智能眼镜 2 产品示意图



资料来源：华为官网，中原证券研究所

雷鸟发布 AI 拍摄智能眼镜及全彩光波导 AR 眼镜。2025 年 1 月 7 日，雷鸟 V3 AI 拍摄智能眼镜正式发布，售价 1799 元起；雷鸟 V3 搭载第一代高通骁龙 AR1 平台，采用台积电 4nm 工艺；搭载与 TCL 联合调教的“猎鹰影像”，采用 5 层镀膜光学镜片，搭载索尼 IMX681 背照式 CMOS；雷鸟 AI 支持全景式智能搜索，覆盖海量知识领域；电池容量 159mAh，40 分钟可充满，可用 7 小时；重量为 39g（不含镜片），采用钛合金金属转轴、肤感鼻托，专为亚洲人脸型设计。2025 年 5 月 27 日，雷鸟 X3 Pro 旗舰 AR 眼镜正式发布；雷鸟 X3 Pro 为全彩光波导 AR 眼镜，采用新一代二维扩瞳衍射光波导镜片，搭载新一代萤火光引擎，采用三色合色全彩方案，内置 JBD 定制红绿蓝三原色屏幕，配合 0.1cc 超小聚合 Cube 棱镜，实现 1670 万色全彩显示输出，峰值入眼亮度 6000nits，平均入眼亮度 3500nits，光引擎大小 0.36cc；雷鸟 X3 Pro 推出安卓虚拟机功能，可将手机 App 搬到眼镜中使用；持语音翻译、同声传译、图像翻译等多种翻译模式，以及高德地图 AR 导航、AI 助手连续对话等功能。

图 31：雷鸟 V3 AI 眼镜产品示意图



资料来源：IT 之家，中原证券研究所

图 32：雷鸟 X3 Pro AR 眼镜产品示意图



资料来源：IT 之家，中原证券研究所

Meta 与欧克利联合发布新款 AI 眼镜 Oakley Meta HSTN。2025 年 6 月 21 日，Meta 与美国知名运动品牌欧克利（Oakley）联合发布了新款 AI 眼镜 Oakley Meta HSTN，其定位为“高性能 AI 眼镜（Performance AI Glass）”，主打运动场景。Oakley Meta HSTN 支持 POV

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

视频拍摄、Meta AI 助理，常规使用状态下续航时间可达 8 小时，待机续航时间长达 19 小时，并且支持快充；这款眼镜采用最先进的 Oakley PRIZM 镜片，结合 Oakley 的 PRIZM Lens 技术，旨在帮助运动员在不断变化的光线和天气条件下获得更清晰的视野；该产品将于 7 月 11 日开始预售，起售价 399 美元（约 2868 元人民币），限量版 499 美元（约 3587 元人民币）。

图 33：Oakley Meta HSTN AI 眼镜产品示意图



资料来源：IT 之家，中原证券研究所

图 34：Oakley Meta HSTN AI 眼镜产品示意图



资料来源：IT 之家，中原证券研究所

小米发布首款 AI 眼镜。2025 年 6 月 26 日，小米首款 AI 眼镜发布，小米 AI 眼镜是面向下一代的个人智能设备，售价 1999 元起，电致变色版本 2699 元，彩色版本 2999 元。小米 AI 眼镜采用经典威灵顿式 D 型方框设计，12 度外翻转轴解决传统智能眼镜夹头痛点，40 克裸框重量搭配黑、玳瑁棕、鹦鹉绿三色半透明镜架，支持线下 400 家门店验光与线上定制处方镜片；1200 万像素 IMX681 传感器实现 0.8 秒疾速拍摄与 2K 视频录制；四麦克风阵列结合骨传导技术提升复杂环境收音效果；通过 HyperOS 系统，眼镜可替代手机摄像头用于微信、QQ 视频通话，还与 B 站、抖音等平台打通直播推流功能；内置小爱同学支持十语种同声传译、卡路里识别等 AI 应用，可呼唤小爱同学开启第一人称视角拍摄录像。

图 35：小米 AI 眼镜产品示意图



资料来源：小米官网，中原证券研究所

图 36：小米 AI 眼镜产品示意图



资料来源：小米官网，中原证券研究所

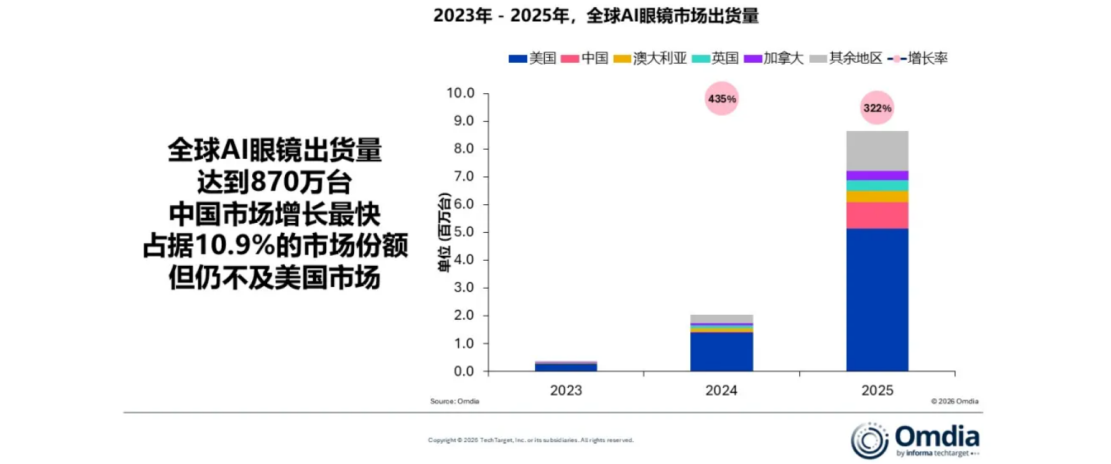
多款 AI 眼镜新品放量在即，有望推动全球 AI 眼镜出货量快速增长。根据 Omdia 的数据，2025 年全球 AI 眼镜出货量达到 870 万台，同比大幅增长 322%；预计 2026 年全球 AI 眼镜出货量将超过 1500 万台，这一增长将由多方面因素推动，包括主要设备厂商和科技巨头进入市场、Meta 提高产量并拓展新区域市场，以及印度、日本和韩国本土厂商的崛起。目前中国大陆市场占全球 AI 眼镜市场 10.9%的份额，出货量接近 100 万台，成为仅次于美国的全球

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

第二大市场。

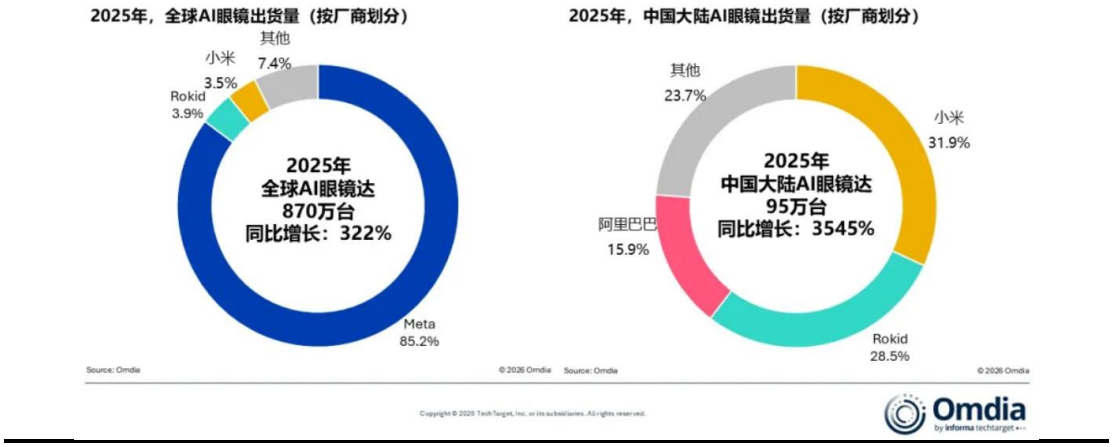
图 37：2023-2025 年全球 AI 眼镜出货量情况



资料来源：Omdia，中原证券研究所

Meta 在全球 AI 眼镜市场占据绝对领先地位，国内厂商快速崛起。根据 Omdia 的数据，2025 年 Meta 的 AI 眼镜出货量达到 740 万台，同比增长 281.3%，市场份额达 85.2%，这一增长主要得益于 Oakley 和第二代 Ray-Ban 品牌 AI 眼镜的强劲表现，同时 Meta 也在积极拓展新市场，包括印度、墨西哥、巴西等国家；中国厂商 Rokid 以及智能手机厂商小米快速崛起，分别位列第二和第三位。

图 38：2025 年全球及中国大陆 AI 眼镜市场竞争格局情况

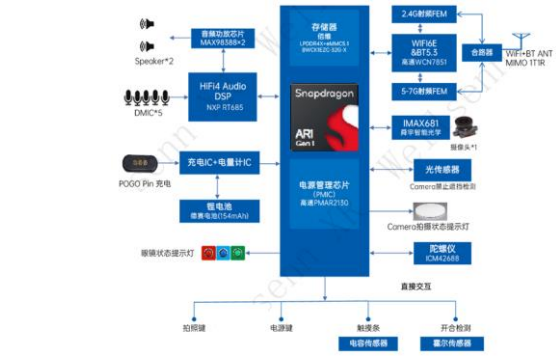


资料来源：Omdia，中原证券研究所

芯片占 AI 眼镜成本大部分，关注 AI 眼镜产业链核心环节投资机会。根据 wellsenn XR 的数据，RayBan Meta AI 眼镜成本总计 174 美元，主板芯片的成本约 99.1 美元，占比约 56.95%，成本占比超一半；眼镜充电盒的成本约 17.5 美元，占比约 10.06%；结构件的成本约 16.9 美元，占比约 9.71%；OEM 的成本约 15 美元，占比约 8.62%。AI 眼镜主要芯片包括 SoC、MCU、存储器、电源、射频等，建议关注 SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM 等产业链核心环节投资机会。

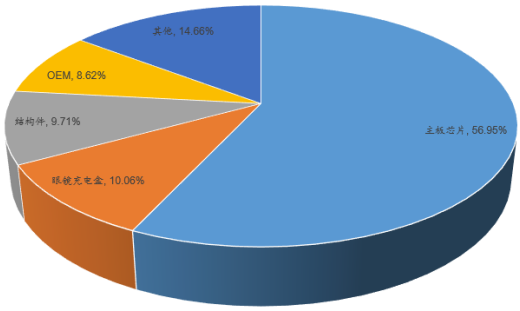
仅供内部参考，请勿外传！

图 39：RayBan Meta AI 眼镜系统架构框图



资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

图 40：RayBan Meta AI 眼镜成本结构图



资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

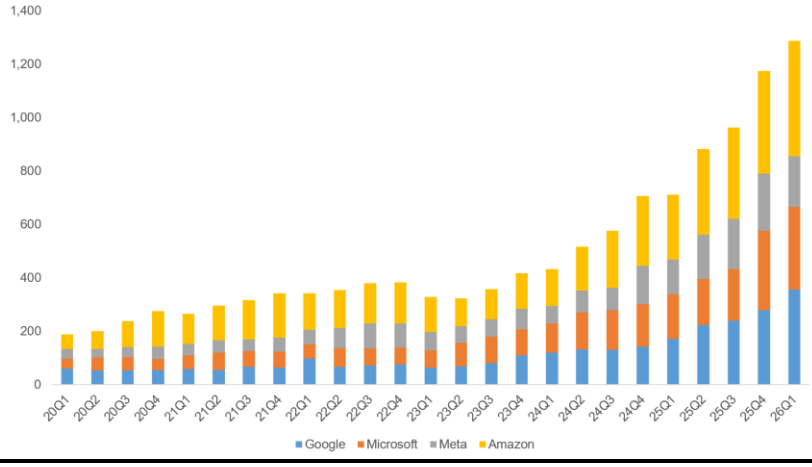
2.2.4. 国内外云厂商不断提升资本支出，推动 AI 算力硬件基础设施需求旺盛

北美四大云厂商受益于 AI 对核心业务的推动，持续加大资本支出。受益于 AI 对于公司核心业务的推动，北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊 2023 年开始持续加大资本支出，2026 年第一季度四大云厂商的资本开支合计约为 1288 亿美元，同比增长 81%，环比增长 10%，推动 AI 算力硬件基础设施需求旺盛。

北美四大云厂商上调 2026 年资本支出计划。目前北美四大云厂商的资本支出增长主要用于 AI 基础设施的投资，并从 AI 投资中获得了积极回报，谷歌预计 2026 年资本支出将增加至 1800-1900 亿美元（原值为 1750-1850 亿美元），并预计 2027 年资本支出将大幅高于 2026 年；Meta 预计 2026 年资本支出为 1250-1450 亿美金（原值为 1150-1350 亿美元）；微软预计 2026 年资本支出约为 1900 亿美元；亚马逊预计 2026 年资本支出约为 2000 亿美元，同比增长 56%，持续加大 AI 基础设施的投资力度。

黄仁勋预计超大规模云厂商 2025-2030 年资本支出复合增速高达 46%。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：超大规模云服务商的资本支出在 2025 年将达到 6000 亿美元，预计 2030 年 AI 基础设施市场规模将达到 3 万亿至 4 万亿美元；因此未来几年，乃至整个十年期，我们都将面临极其迅猛且极具分量的增长机遇。

图 41：2020-2025 年北美四大云厂商资本开支情况（亿美元）



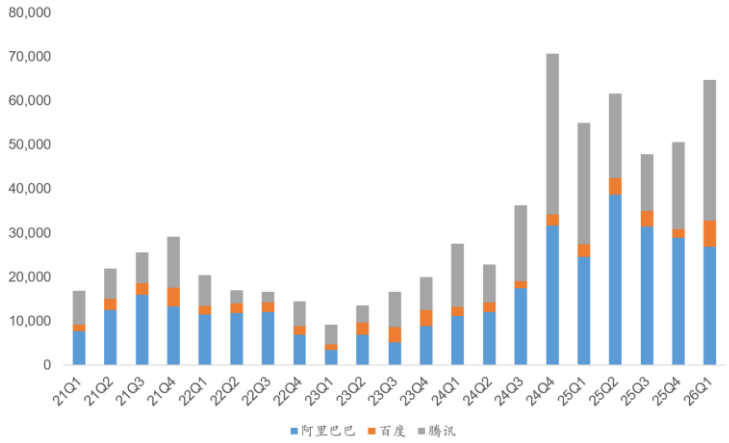
资料来源：各公司公告，Wind，中原证券研究所

国内三大互联网厂商不断提升资本开支。国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯

仅供内部参考，请勿外传！

2023 年也开始不断加大资本开支，2026 年一季度三大互联网厂商的资本开支合计约为 647 亿元，同比增长 18%，环比增长 28%；预计 2026 年国内三大互联网厂商将继续加大用于 AI 基础设施建设的资本开支。

图 42：2021-2026 年国内三大互联网厂商资本开支情况（百万元）

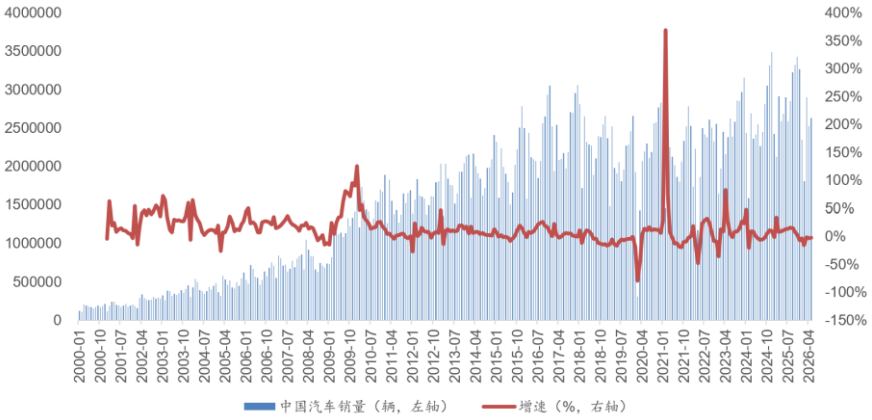


资料来源：各公司公告，中原证券研究所

2.2.5. 中国新能源汽车月度销量同比稳健增长

2026 年 5 月中国汽车销量同比下降 2.1%。根据中国汽车工业协会的统计数据，2026 年 5 月，中国汽车销量达到 262.9 万辆，同比下降 2.1%，环比增长 4.1%。2026 年 5 月，受政策调整、市场结构变化、宏观环境承压等多重因素影响，国内市场同比继续呈现两位数下滑；出口发展强劲，延续快速增长态势。

图 43：2000-2026 年中国汽车销量情况



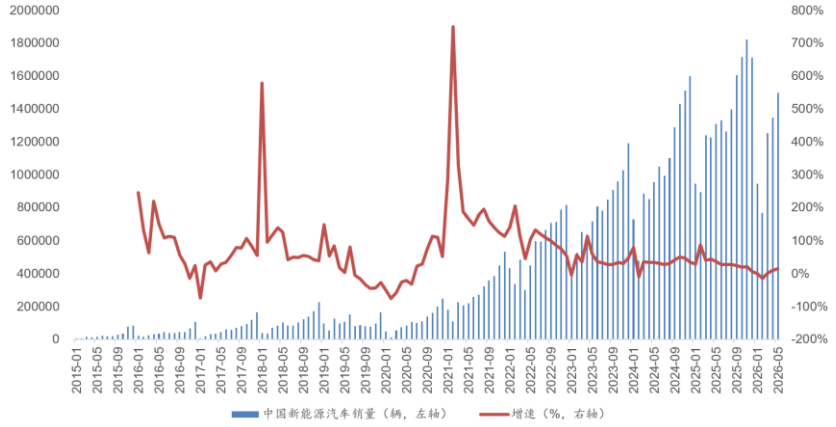
资料来源：中国汽车工业协会，Wind，中原证券研究所

2026 年 5 月中国新能源汽车销量同比增长 14.4%。根据中国汽车工业协会统计数据，2026 年 5 月，中国新能源汽车销量 149.6 万辆，同比增长 14.4%，环比增长 11%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 56.9%。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

图 44：2015-2026 年中国新能源汽车销量情况

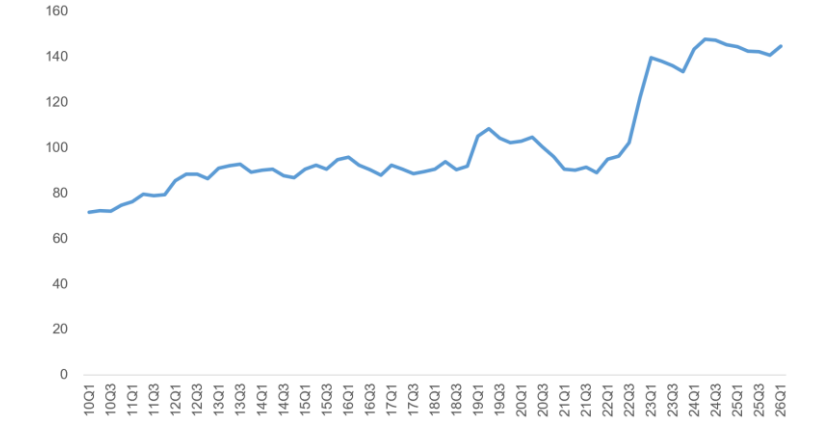


资料来源：中国汽车工业协会，Wind，中原证券研究所

2.3. 全球部分芯片厂商季度库存水位环比小幅提升，国内部分芯片厂商季度库存水位环比大幅提升

全球部分芯片厂商 26Q1 库存水位环比小幅提升。根据 Wind 的数据，全球部分芯片厂商包括英特尔、AMD、英伟达、高通、博通、美光、TI、ADI、恩智浦、微芯、安森美 23Q1 的平均库存周转天数为 139 天，23Q4 下降至 133 天，随后开始环比提升，24Q2 提升至 148 天，24Q3 为 147 天，环比基本持平，24Q4 小幅下降至 145 天，25Q1 小幅下降至 144 天，25Q2 继续下降至 142 天，25Q4 小幅下降至 141 天，26Q1 小幅提升至 145 天；由于工业市场需求开始复苏，模拟厂商 TI、ADI、微芯科技等库存有望逐步下降。

图 45：全球部分芯片厂商平均库存周转天数情况



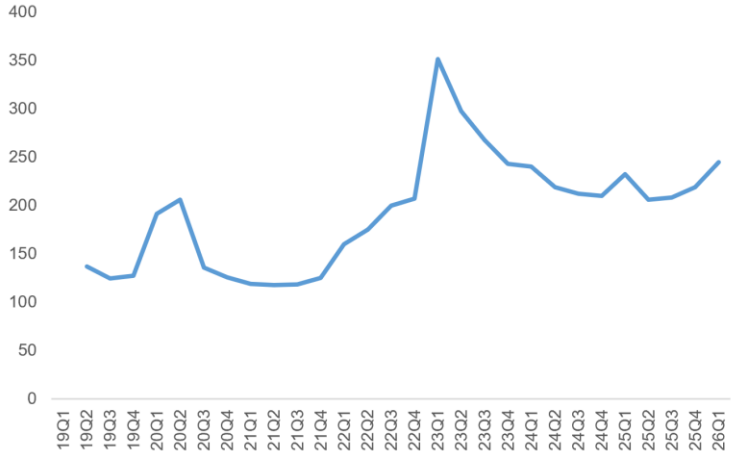
资料来源：Wind，中原证券研究所（注：包括英特尔、AMD、英伟达、高通、博通、美光、TI、ADI、恩智浦、微芯、安森美）

国内部分芯片厂商 26Q1 库存水位环比大幅提升。国内部分芯片厂商包括兆易创新、卓胜微、韦尔股份、澜起科技、晶晨股份、瑞芯微、北京君正、圣邦股份、紫光国微 23Q1 的平均库存周转天数达到 351 天，24Q1 下降到 240 天，24Q4 继续下降到 210 天，25Q1 提升至 232 天，25Q2 大幅下降至 206 天，25Q3 小幅提升至 208 天，25Q4 提升至 219 天，26Q1 继续提升至 245 天，环比提升 26 天。26Q1 国内部分芯片厂商库存水位环比大幅提升，目前部分芯片设计厂商库存仍偏高，预计后续有望逐步回到健康水平。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

图 46：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况

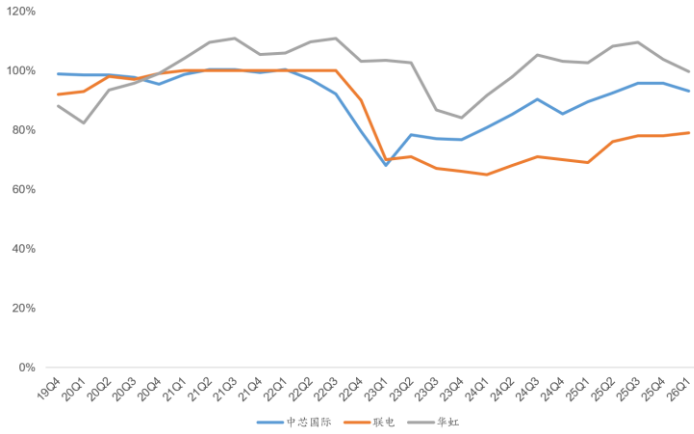


资料来源：Wind，中原证券研究所（注：包括兆易创新、卓胜微、韦尔股份、澜起科技、晶晨股份、瑞芯微、北京君正、圣邦股份、紫光国微）

2.4. 国内主要晶圆厂季度产能利用率环比小幅回落

国内主要晶圆厂产能利用率 26Q1 环比小幅回落。半导体市场需求自 2022 年三季度大幅下跌，导致芯片原厂流片意愿不强，晶圆厂的产能利用率也出现下滑；国内晶圆代工龙头中芯国际 23Q1 的产能利用率从 22Q4 的 79.5%大幅下降至 68.1%，23Q2 至 23Q4 产能利用率在 76%-78%区间波动，24Q1 至 24Q4 产能利用率在 80%-90%区间波动，25Q1 至 25Q4 产能利用率从 89.60%提升至 95.7%，26Q1 产能利用率为 93.1%。联电 23Q1 的产能利用率从 22Q4 的 90%下降至 70%，23Q2 则小幅提升至 71%，23Q3 至 24Q2 产能利用率在 65%-68%区间波动，24Q3 至 25Q1 从 71%回落至 69%，25Q2 大幅提升至 76%，25Q3 继续提升至 78%，25Q4 持平，26Q1 提升至 79%。华虹半导体 23Q2 产能利用率从 23Q1 的 103.5%略微下降至 102.7%，随后开始大幅下降，23Q4 下滑至 84.1%，24Q1 大幅提升至 91.7%，24Q2 至 24Q3 持续提升至 105.3%，24Q4 至 25Q1 小幅回落至 102.70%，25Q2 至 25Q3 继续提升至 109.5%，25Q4 回落至 103.8%，26Q1 小幅回落至 99.7%；26Q1 中芯国际、华虹产能利用率环比小幅回落，但仍处于满负荷运行状态。

图 47：全球部分晶圆厂产能利用率情况



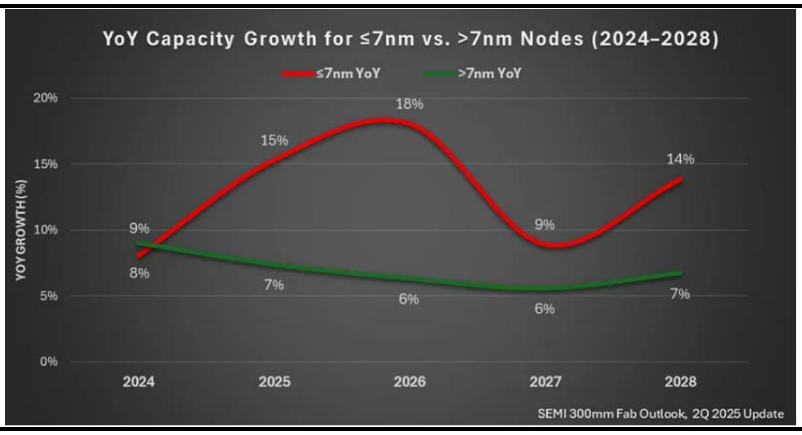
资料来源：各公司公告，中原证券研究所

AI 推动全球先进制造产能加速扩张。根据 SEMI 发布最新的《300 毫米晶圆厂展望报告

仅供内部参考，请勿外传！

（300mm Fab Outlook）》，全球半导体制造行业预计将保持强劲增长势头，预计从 2024 年底到 2028 年，产能将以 7%的复合年增长率增长，达到创纪录的每月 1110 万片晶圆；推动这一增长的关键因素是先进工艺产能（7 纳米及以下）的持续扩张，预计将从 2024 年的每月 85 万片晶圆增长到 2028 年的历史新高 140 万片晶圆，增长约 69%，复合年增长率约为 14%，是行业平均水平的两倍；AI 继续成为全球半导体行业的变革力量，推动全球先进制造产能加速扩张。

图 48：2024-2028 年全球晶圆产能及预测情况



资料来源：SEMI，中原证券研究所

TrendForce 预计晶圆代工成熟制程涨价效应有望延伸至 2027 年。根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，随着 AI 服务器、通用服务器与边缘 AI 周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝 AI 相关产品倾斜，加速改变成熟制程供需结构；8 英寸制程受益于 AI 相关电源订单增量及台积电、三星电子减产，产能利用率与代工价格强势拉升；12 英寸成熟制程则因台积电启动减产，有望带动中长期转单效应；加上 55nm（含）以上 Power IC 订单强劲，引发台系晶圆厂减产 High Voltage（HV）制程、订单流向大陆系厂供应链等效应，以及 AI 相关新兴应用增量排挤、原物料通膨等因素，导致 12 英寸成熟制程代工涨价氛围，预计涨势将延伸至 2027 年。

图 49：25H2-26H2 晶圆代工价格涨幅变化情况

2H25-2H26晶圆代工价格涨幅变化

Process Node	2H25	1H26	2H26
8-inch Processes	5-10% (specific processes only)	5-15%	0-10%
12-inch Mature Nodes	Flat	Flat	0-10%
12-inch Advanced Nodes	Flat	5-10%	Flat

Source: TrendForce, June 2026

TrendForce

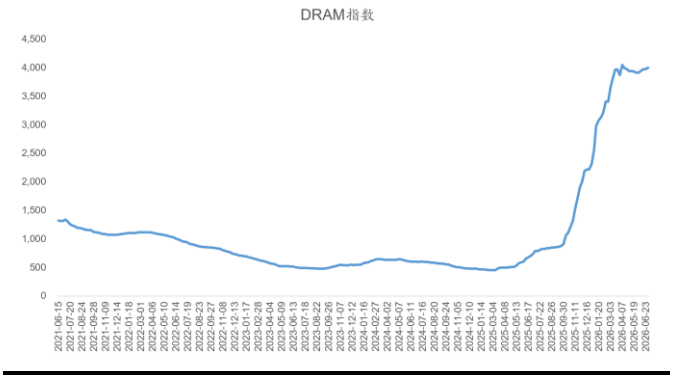
资料来源：TrendForce，中原证券研究所

2.5. DRAM 月度现货价格环比恢复上涨，NAND Flash 现货价格环比小幅下降

仅供内部参考，请勿外传！

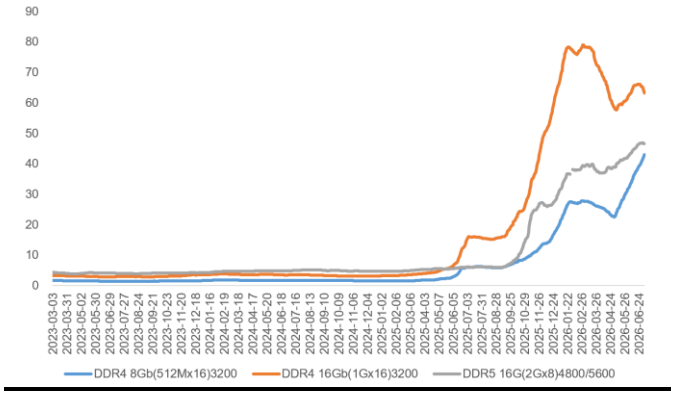
2026 年 6 月 DRAM 现货价格恢复环比上涨。根据中国闪存市场的数据，2026 年 6 月 DRAM 指数环比上涨约 2.21%，2025 年 3 月至 2026 年 6 月 DRAM 指数上涨约 783%。根据 DRAMexchange 的数据，2026 年 6 月，DDR4 8Gb(512Mx16)3200 的现货价格环比上涨 29.54%，DDR4 16Gb(1Gx16)3200 的现货价格环比上涨 5.61%，DDR5 16G(2Gx8)4800/5600 的现货价格环比上涨 10.79%。

图 50：DRAM 指数走势情况



资料来源：中国闪存市场，iFinD，中原证券研究所

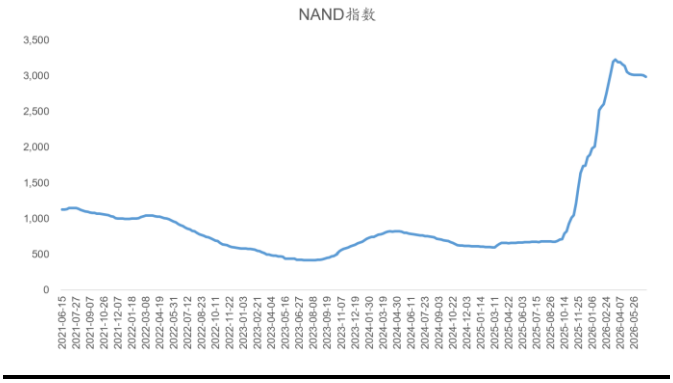
图 51：DRAM 现货价格走势情况（美元）



资料来源：DRAMexchange，iFinD，中原证券研究所

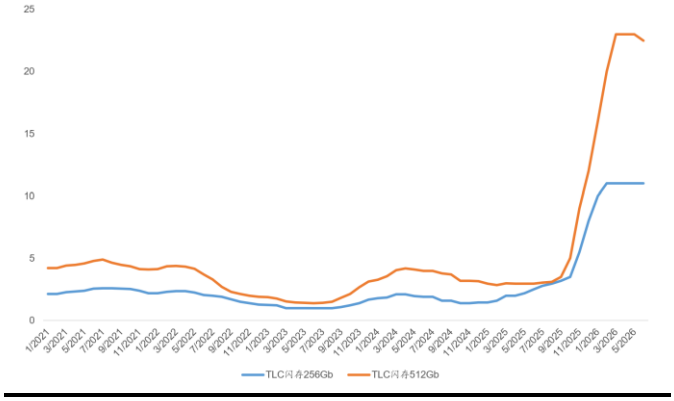
2026 年 6 月 NAND Flash 现货价格环比小幅下降。根据中国闪存市场的数据，2026 年 6 月 NAND 指数环比下降约 0.90%，2025 年 3 月至 2026 年 6 月 NAND 指数上涨约 397%；其中 TLC 闪存 256Gb 的现货价格环比持平，512Gb 的现货价格环比下降 2.17%。

图 52：NAND 指数走势情况



资料来源：中国闪存市场，iFinD，中原证券研究所

图 53：NAND Flash 现货价格走势情况（美元）



资料来源：InSpectrum，中国闪存市场，中原证券研究所

TrendForce 预计 26Q3 DRAM 及 NAND Flash 合约价格分别环比增长 13-18%及 10-15%。根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，2026 年第三季度整体 DRAM 格局持续极度紧缺，但因消费级应用需求下修及高基期作用，合约价涨幅收敛，预计 26Q3 将环比增长 13-18%；NAND Flash 主要需求仍由 AI 推理与大型数据中心建设支撑，但因合约价格已达历史高点，消费端客户在需求放缓的情况下，对价格承受力已达极限，预估 26Q3 整体 NAND Flash 合约价将环比增长 10-15%，幅度较前几季明显缩减。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

图 54：26Q2-26Q3 DRAM 及 NAND Flash 产品合约价格预测情况

2Q26-3Q26 DRAM、NAND Flash合约价格预测

	2Q26	3Q26E
Total DRAM	Conventional DRAM: up 58~63% HBM Blended: up 53~58%	Conventional DRAM: up 13~18% HBM Blended: up 8~13%
Total NAND Flash	up 55~60%	up 10~15%

Source: TrendForce, July 2026

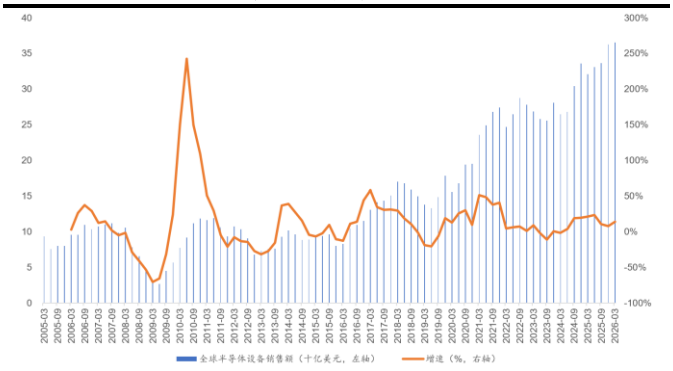
TrendForce

资料来源：TrendForce，中原证券研究所

2.6. 全球半导体设备季度销售额继续同比增长，预计 2026 年有望持续增长

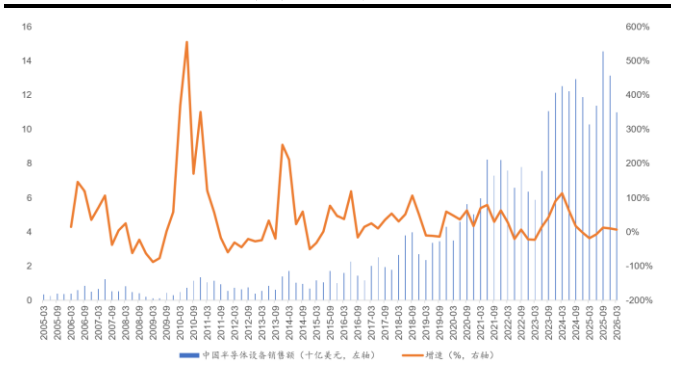
26Q1 全球半导体设备销售额同比增长 14%，中国半导体设备销售额同比增长 7%。根据日本半导体制造装置协会（SEAJ）的数据，2026 年第一季度全球半导体设备销售额为 365.5 亿美元，同比增长 14%，环比增长 1%；2026 年第一季度中国半导体设备销售额为 109.9 亿美元，同比增长 7%，环比下降 16%。

图 55：2005-2026 年全球半导体设备销售额情况



资料来源：SEAJ，iFinD，中原证券研究所

图 56：2005-2026 年中国半导体设备销售额情况



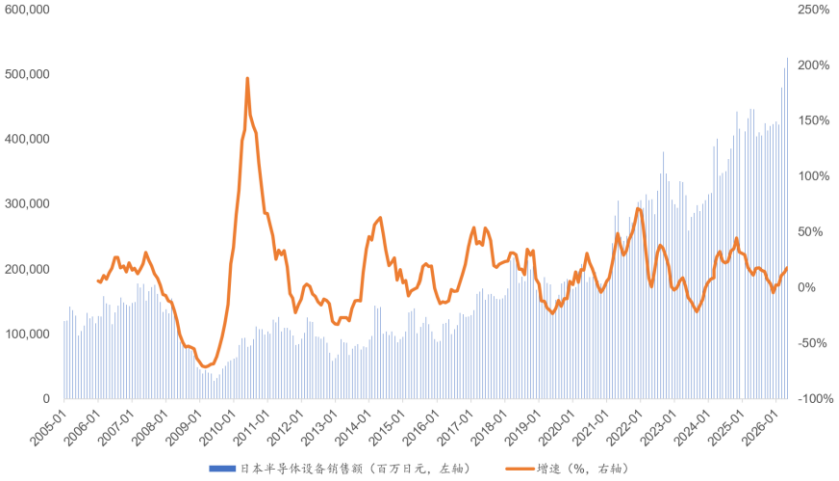
资料来源：SEAJ，iFinD，中原证券研究所

2026 年 5 月日本半导体设备销售额同比增长 17.9%。根据日本半导体制造装置协会的数据，2026 年 5 月日本半导体设备销售额为 5263.52 亿日元，同比增长 17.9%，环比增长 3.2%；2025 年日本半导体设备销售额达 5.0585 万亿日元，同比增长 14%；日本半导体设备全球市场占有率达三成，仅次于美国位居全球第 2。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

图 57：日本半导体设备月度销售额情况

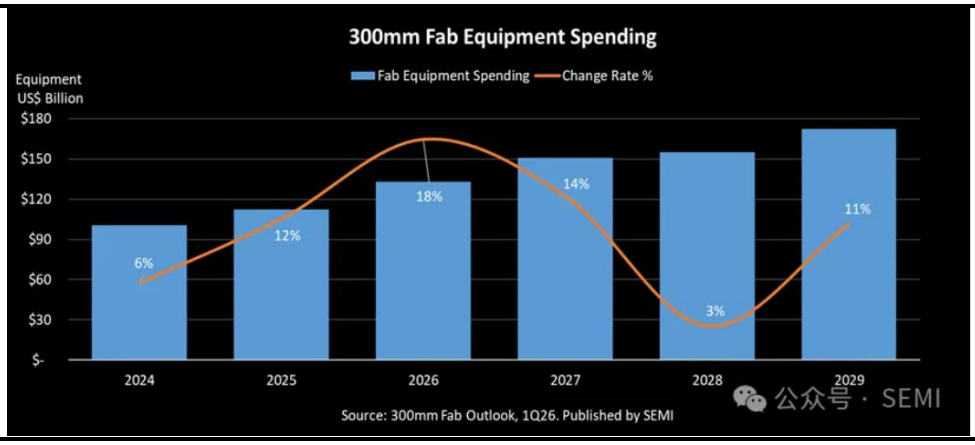


资料来源：SEAJ，iFinD，中原证券研究所

SEMI 预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出将同比增长 18%。根据 SEMI 的最新预测，全球 300mm 晶圆厂设备支出预计 2026 年将增长 18%至 1330 亿美元，2027 年将增长 14%至 1510 亿美元，2028 年将继续增长 3%至 1550 亿美元，2029 年再增长 11%至 1720 亿美元；这一强劲增长反映了数据中心和边缘设备对 AI 芯片需求的激增，以及各主要地区通过本地化产业生态系统和供应链重组来加强半导体自给自足能力的坚定承诺。

SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示："AI 正在重塑半导体制造投资的规模，随着全球 300mm 晶圆厂设备支出预计在 2027 年首次突破 1500 亿美元，行业正以史无前例的持续性的投入，着力构建 AI 时代所需的先进产能与韧性供应链。"

图 58：2024-2029 年全球 300mm 晶圆厂设备支出情况及预测



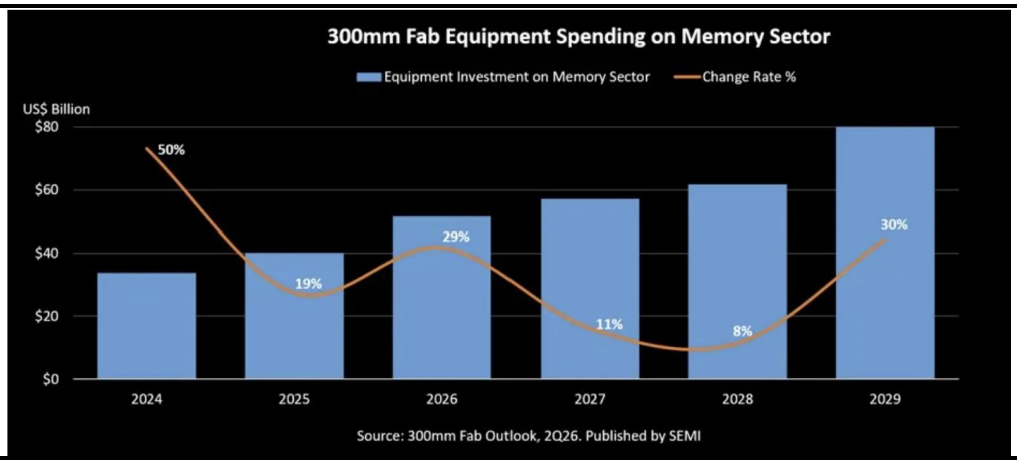
资料来源：SEMI，中原证券研究所

SEMI 预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资将同比增长 29%。根据 SEMI 的最新预测，受 AI 基础设施、数据中心及下一代计算系统投资增加的支撑，2026 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资预计将达到 520 亿美元，同比增长 29%，预计 2027 年再增 11%至 570 亿美元，预计 2024-2029 年复合增速将达 19%。

SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示："对 HBM 及其他先进存储技术的强劲需求正在重塑整个半导体供应链的投资优先级，随着 AI 基础设施的扩张，存储制造商正在加速产

能和技术迁移方面的投资，以支持下一波数据密集型应用。”

图 59：2024-2029 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资情况及预测

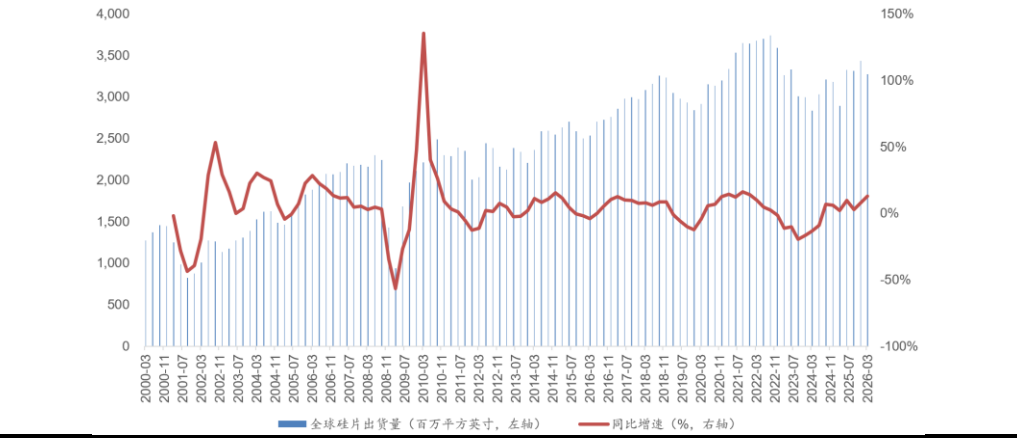


资料来源：SEMI，中原证券研究所

2.7. 全球硅片季度出货量继续同比增长，预计 2026 年将持续增长

26Q1 全球硅片出货量同比增长 13.1%。硅片是半导体产业链中最重要的材料之一，也是价值含量最高的半导体材料，占整个晶圆制造材料超过 33%。根据 SEMI 的数据，2026 年第一季度全球硅晶圆出货量达到 3275 百万平方英寸，同比增长 13.1%，环比下降 4.7%，符合典型的季节性规律。SEMI SMG 主席、胜高株式会社（SUMCO）销售与市场事业部总经理矢田银次（Ginji Yada）表示：“与 AI 数据中心相关的硅晶圆需求持续强劲，包括先进逻辑芯片和存储芯片，目前也已扩展至功率管理器件；总体而言，硅晶圆需求有所改善，但复苏还不均衡；许多器件公司已注意到工业半导体领域的改善，随着晶圆库存被消化，这正在推动更为广泛的复苏；今年第一季度智能手机和 PC 出货量较弱，可能反映了 AI 高带宽存储器（HBM）的产能分配决策对存储器供应趋紧的影响。”

图 60：全球硅片出货量情况



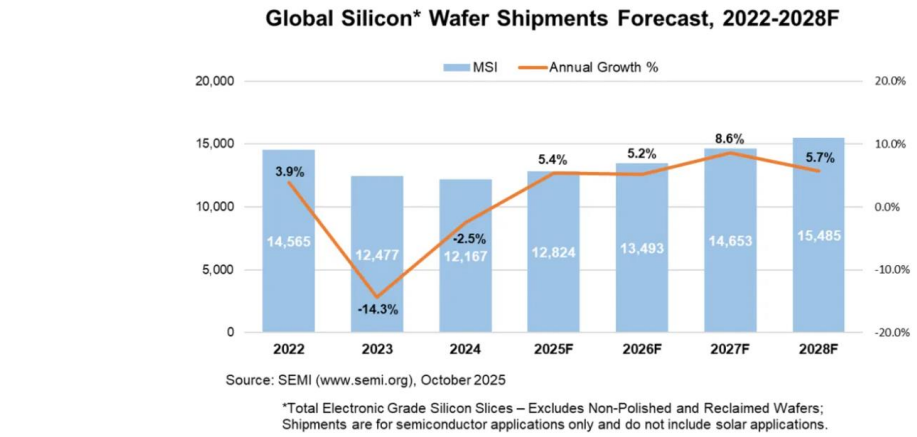
资料来源：SEMI，Wind，中原证券研究所

SEMI 预计 2025-2028 年全球硅晶圆出货量将持续增长。根据 SEMI 的预测，预计 2026 年全球硅晶圆出货量预计将增长 5.2%，并将在 2028 年前持续增长，届时市场有望达到 15485 百万平方英寸的新行业纪录。2025 年硅晶圆出货量的增长主要受益于人工智能相关需求的强劲推动，包括用于先进逻辑器件的高端外延晶圆，以及用于高带宽存储器（HBM）的

仅供内部参考，请勿外传！

抛光晶圆；非 AI 应用领域的晶圆出货量则刚刚开始从近期的下行周期中逐步恢复；预计随着 AI 在数据中心及边缘计算领域的持续扩展，这一稳步增长趋势将延续至 2028 年。

图 61：2022-2027 年全球硅片出货量情况及预测



资料来源：SEMI，中原证券研究所

3. 行业政策

外部环境对中国半导体产业限制不断加剧。近年来美日荷不断加大对中国半导体产业的限制，主要针对半导体先进制造、先进制程半导体设备、先进存储器、先进计算芯片、EDA 工具等环节。

表 10：近年美日荷对中国半导体产业部分制裁政策情况

时间	具体事件及制裁政策情况
2018 年 10 月	美国商务部将福建省晋华集成电路有限公司列入出口管制“实体清单”。
2019 年 7 月	ASML 中止向中国交付 EUV 光刻机。
2020 年 5 月	美国商务部限制华为使用美国技术和软件在海外设计和制造半导体。
2020 年 9 月	美国商务部对华为实施严格的芯片禁令正式生效，台积电停止为华为代工生产麒麟芯片，高通、三星及 SK 海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。
2020 年 12 月	美国商务部将中芯国际列入出口管制“实体清单”。
2022 年 8 月	美国总统拜登签署《2022 芯片与科学法案》，该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供 527 亿美元，获得补贴的半导体企业将禁止在中国扩大或新增 14 纳米及以下先进制程芯片产业的投资。
2022 年 8 月	美国芯片厂商英伟达和 AMD 收到美国政府通知，要求停止向中国出口用于人工智能的高端计算芯片，该禁令影响的芯片分别为英伟达的 GPU A100 与 H100，以及 AMD 的 GPU MI200。
2022 年 10 月	美国商务部公布一系列针对中国的出口管制新规，BIS 这项新的半导体出口限制政策涉及到对中国的先进计算、半导体先进制造进行出口管制；具体要限制美国的半导体设备在国内应用到 16/14nm 及以下工艺节点（非平面架构）的逻辑电路制造、128 层及以上的 3D NAND 工艺制造、18nm 及以下的 DRAM 工艺制造；对中国超级计算机或半导体开发或生产最终用途的项目进行限制；限制美国公民支持中国半导体制造或者研发。
2022 年 12 月	美国商务部将长江存储、上海微电子、寒武纪等 36 家中国实体加入出口管制“实体清单”。
2023 年 5 月	日本政府正式发布针对先进芯片制造所需的 23 种半导体制造设备的出口管制措施，这些设备包括 3 项清洗设备、11 项薄膜沉积设备、1 项热处理设备、4 项光刻设备、3 项蚀刻设备、1 项测试设备。
2023 年 6 月	荷兰政府正式发布针对先进的芯片制造技术，包括先进的沉积设备和浸润式 DUV 光刻机实施出口管制。
2023 年 10 月	美国商务部公布针对先进计算芯片、半导体制造设备出口管制的更新规则，并将 13 家中国 GPU 企业列入实体清单，主要为壁仞科技和摩尔线程及其子公司。
2024 年 12 月	美国商务部修订了《出口管理条例》，这次制裁主要涉及半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并且扩展了对华出口管制的范围，包括了 24 种半导体制造设备、3 种软件工具和 HBM 芯片出口的限制，将 140 个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。新进入“实体清单”的企业包括北方华创、盛美上海、芯源微、拓荆科技、华峰测控、中科飞测、精测电子、华海清科、凯世通、至纯科技、武汉新芯、华大九天、沪硅产业、南大光电、闻泰科技、建广资本、智路资本等。
2025 年 1 月	美国商务部修订了《出口管理条例》，将中国 11 个实体加入实体清单，包括中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院上海光学精密机械研究所、苏州超纳精密光电技术有限公司、南京施密特

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

	光学仪器有限公司等，自 1 月 6 日起生效。从 2025 年 1 月 2 日起，包括美国公民、持有“绿卡”的合法永久居民在内的美国人士，在美国设立的实体及其外国分支机构，以及在美国境内的任何个人或实体，都禁止投资或需要申报才能投资中国的半导体和微电子、量子信息技术以及人工智能三个行业。
2025 年 1 月	美国国防部发布最新版的“中国涉军企业”清单（根据美国法律正式规定为“第 1260H 条名单”），将腾讯控股、宁德时代、长鑫存储、长江存储、华为控股、中芯国际、奇虎 360 公司、中国移动、中国联通、中国电信、华大基因等 134 家中国企业新增列入该清单。
2025 年 1 月	美国政府推出《人工智能扩散规则》，公布对 AI 芯片出口的新限制措施，这份新规将出口目的地分为三类，美国对 18 个关键盟友与合作伙伴的芯片销售无任何限制；对中国、伊朗等实施了严格的 AI 芯片销售限制；对其他国家，大多数国家则将面临总算力限制，每个国家在 2025 年至 2027 年期间最多可获得约 5 万个 AI GPU。
2025 年 1 月	美国商务部修订了《出口管制条例》，共增加了 25 个中国实体，主要包括智谱旗下 10 个实体、算能旗下约 11 个实体，以及哈勃投资的光刻机企业科益虹源等；BIS 还更新先进计算半导体的出口管制，针对于先进逻辑集成电路是采用“16nm/14nm 节点”及以下工艺、或采用非平面晶体管架构生产的逻辑集成电路，采取更多审查和规范，并且细化了多个物项信息如 DRAM 行业 18 纳米半间距节点的生产标准等。
2025 年 5 月	美国商务部宣布废除拜登政府此前推出的《人工智能扩散规则》（AI Diffusion Rule），并同时宣布三项旨在加强海外 AI 芯片出口管制的新举措：全球禁用华为 Ascend 芯片，明确在世界任何地区使用华为 Ascend 芯片均被视为违反美国出口管制条例；限制 AI 芯片用于中国 AI 模型，若美国 AI 芯片被用于训练或干扰中国人工智能模型，相关企业将面临严重后果；供应链反制指南，要求美国企业重新审视供应链合作伙伴，强化审查机制，防范技术转移风险。

资料来源：中华人民共和国商务部官网，美国商务部官网，美国政府官网，人民网，央视网，芯智讯，日经新闻，中芯国际公司公告，半导体产业纵横，腾讯，芯榜，中原证券研究所

4. 行业动态

4.1. 全球半导体行业动态

1、英特尔发布全球首款 1.8nm 数据中心 CPU

2026 年 6 月 1 日消息，在英特尔在 Computex 2026 台北国际电脑展期间发布采用 Intel 18 制程的新一代数据中心 CPU 至强 6+（代号 Clearwater Forest），推出全新以太网解决方案 E835，并展示了面向 AI 推理的英特尔数据中心 GPU（代号 Crescent Island）。这是首款基于 Intel 18A 制程（1.8nm 级）生产、采用 Foveros Direct 3D 先进封装技术的数据中心 CPU。

至强 6+拥有 288 个 E-core（能效核），配备 96 条 PCIe Gen5 通道，支持 8000MT/s12 通道 DDR5 内存、576MB 末级缓存（LLC），搭载英特尔软件防护扩展（SGX）、英特尔可信域扩展（TDX）、英特尔应用能耗遥测（AET）等技术，TDP 范围为 330-450W，支持单路和双路平台配置。与上一代 Sierra Forest 及 AP 型号相比，至强 6+的单路核心数量翻倍，同时提升了内存通道数与内存速率，内存带宽显著增长，还增加了 PCIe 通道数，并完整搭载业界熟知的全套安全特性、可管理特性与硬件加速能力。与竞品相比，至强 6+每线程性能提升高达 30%。与上一代相比，至强 6+每瓦性能提升达 55%。如果当前客户基础设施当前部署的是第二代至强，升级到至强 6+，则可实现 9:1 的服务器整合比，即减少 79%的数据中心物理占用空间，同时能效水平、电力、冷却需求以及持续运营成本也得到优化。

下一代数据中心 CPU P-core（性能核）产品是 Diamond Rapids，将于 2027 年发布，基于 Intel 18A-P 制程，有翻倍的内存带宽、更多 PCIe 通道和更多的核心数量。

英特尔正在提供不同的解决方案来应对智能体部署需求。至强 CPU 集成了矩阵引擎和向

仅供内部参考，请勿外传！

量引擎，在机架中部署越来越多的核心，内置机密计算、软件加速和压缩技术等特性，并通过AI 软件栈帮助企业顺畅地运行框架及模型。（芯东西）

2、英伟达正式发布 Vera：专为智能体打造的 CPU

2026 年 6 月 1 日消息，在英伟达 GTC 台北大会上，英伟达首款专为 AI 智能体打造的 Vera CPU。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“AI 智能体将成为计算资源的最大用户。Vera 正是为这一未来量身打造的首款 CPU——它具备卓越的性能、能效和可编程性，专为在超大规模下运行智能体 AI 而生。”

AI 工厂的经济衡量标准正在从每美元能买多少“核心”，转向每美元能产出多少“Token”。这就要求 CPU 能够更快、更高效地完成智能体、数据处理以及任务编排等工作。

Vera 搭载了 Olympus 核心，这是 NVIDIA 专为应对上述转变背后的 CPU 工作负载而量身打造的定制 CPU 核心，涵盖了从 Python 运行环境、沙盒代码执行，到任务编排逻辑与分析流水线等各类工作。

Vera 专为处理海量指令、预判应用行为，以及在大量并发的环境、查询和数据处理任务间高效传输数据而生。它搭载了 88 颗 Olympus 核心、空间多线程技术，以及带宽高达 1.2TB/s 的 LPDDR5X 内存子系统。这些特性能够帮助智能体大幅减少在受限于 CPU 的步骤上的等待时间，从而让 AI 工厂里的加速器始终保持高速运转。

Vera CPU 可以灵活部署在整个 AI 工厂中 —— 无论是独立的纯 CPU 基础设施，还是紧密耦合的加速计算系统。Vera 能够帮助 AI 工厂实现更高的端到端吞吐量，并缩短用户的解决方案交付时间，从而全面提升训练、推理以及智能体执行环节的响应速度与运行效率。

Vera 通过第二代 NVIDIA NVLink™-C2C 互连技术，担任 NVIDIA Vera Rubin 平台的主机 CPU。该技术支持 CPU 与 GPU 之间高达 1.8TB/s 的相干带宽，并将 NVIDIA 机密计算扩展至整机架规模，从而为智能体 AI 工作负载提供严密的安全保护。（英伟达）

3、英伟达发布首款 PC 超级芯片

2026 年 6 月 2 日消息，英伟达 CEO 黄仁勋在 COMPUTEX 2026 发表主题演讲。黄仁勋称智能体 AI（Agentic AI）时代全面到来，token（词元）成为了利润单位，AI 成为了利润和 GDP 的“生成器”：“算力即收入，算力即利润。”同时，英伟达正式进军 PC（个人电脑）市场，在会上发布为 Windows 笔记本电脑和小型工作站设计、基于 Arm 架构的 RTX Spark 超级芯片，将其称为“有史以来最高效的平台”。

黄仁勋表示，公司专为 AI 智能体打造的 Vera CPU 已全面投产，速度比 x86 处理器快 1.8 倍，可驱动各行各业的多样化工作负载。

黄仁勋表示，“智能体 AI 已经到来，有用的 AI 已经到来”。在 2026 年前几个月，GitHub 上的代码提交量几乎翻了三倍（从 2025 年的 5 亿次至 14 亿次）。AI 不仅能改变软件开发，还

仅供内部参考，请勿外传！

将创造更多岗位："软件工程师的数量正在增加。人们谈论 AI 减少了工作岗位，这完全是胡说八道，实际上有更多软件工程师被雇用。"

黄仁勋进一步指出，传统的"应用代码在操作系统内运行"的模式已经被打破。智能体（Agent）的新模式以大语言模型（LLM）为核心，通过安全套件（Harness）进行编排，处理包含工作记忆（KV Cache）、长期记忆、工具使用（如浏览器、数据库）的复杂工作流。（芯闻社）

4、英伟达 Spectrum-X 以太网硅光技术全面量产产

2026 年 6 月 2 日消息，英伟达 Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X 交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持 NVIDIA Vera Rubin 平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署 AI 工厂。

该平台通过与中国台湾地区半导体和系统生态合作伙伴的深度协同工程实现量产，台积电、SPIL、TFC 和 Foxconn 分别为从硅光到系统的流程关键层提供了突出贡献：

台积电先进的硅光制造技术，将突破性设计转化为可投入生产的芯片；SPIL 的芯片级封装、组装和测试技术，将电气和光学组件以微米级精度结合在一起；TFC 的激光芯片经过模组封装，提供满足全年全天候运行的 AI 工作负载所需的可靠性要求；Foxconn 的系统组装将 Spectrum-X CPO 交换机集成到完整的机架型网络平台中。

英伟达 AI 工厂系统在 NVIDIA 自有和运营的 AI 工厂内进行拆箱、安装和通电，在客户发货前验证整体工作流。

Spectrum-X 以太网硅光技术是 NVIDIA 全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X 以太网硅光技术可实现能效提升 5 倍，AI 正常运行时间提升 5 倍，部署时间快 1.3 倍。

凭借简化设计，为计算释放更多电力，NVIDIA 光电一体封装技术网络为百万 GPU AI 工厂提供了基础架构，CoreWeave、Lambda 和 Oracle Cloud Infrastructure 等公司已率先采用该技术。

通过大规模部署 CPO 实践，NVIDIA 消除了光互连的功率、可靠性和部署时间上限，即消除了限制 AI 集群增长的关键因素之一。（英伟达）

5、SK 海力士计划 2030 年 DRAM 月产能接近翻倍

2026 年 6 月 5 日消息，据 The Elec 报道，SK 海力士已向核心供应商披露计划，拟在 2030 至 2031 年间将 DRAM 月产晶圆数量从目前约 55 万片提升至约 100 万片，几乎翻倍。这与 SK 集团会长崔泰源（Chey Tae-won）在 2026 年 COMPUTEX 展会上的公开表态相吻合——他当时宣称公司将"以全速在五年内将整体晶圆产能翻倍"。

此次扩产计划的核心落点在韩国龙仁半导体集群，SK 海力士已将首座龙仁晶圆厂的首批

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

设备安装时间从 2027 年 5 月提前至 2027 年 2 月，加速推进态势明显。与此同时，三星电子也在加快平泽 P4 厂的 DRAM 扩产节奏，两大巨头的同步提速，预示着全球 DRAM 供给侧将在本十年末迎来显著扩张。（The Elec，新浪）

6、英伟达与 SK 海力士宣布多年期技术合作，共同开发下一代 AI 内存

2026 年 6 月 8 日消息，英伟达与 SK 海力士宣布建立多年期技术合作伙伴关系，围绕全球 AI 工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，并将 AI 技术应用于半导体芯片设计与制造。

根据协议，SK 海力士将为英伟达 Vera Rubin AI 超级计算机、Vera CPU、RTX Spark PC 及 Jetson Thor 机器人计算平台协同开发专用内存，由此进入英伟达正在开拓的 AI 基础设施、个人 AI 及物理 AI 等新市场。

在半导体制造领域，SK 海力士将采用英伟达 CUDA-X 库及 PhysicsNeMo 框架加速芯片仿真和光刻计算工作流；同时借助英伟达 Omniverse 和 cuOpt 构建晶圆厂数字孪生，推动工厂自主化运营。（界面新闻）

7、宏微科技发布涨价函

2026 年 6 月 23 日消息，当前，全球半导体产业链上游核心资金属价格持续剧烈波动，公司产品制造成本持续攀升。与此同时，下游需求不晰断增长，我司产能趋紧，主流产品交货周期被追延长。面对成本及供需层面的双重压力，为保障公司可持续运营及长期稳定供货，经公司市慎谬估，决定对部分产品实施涨价，涨价涉及 IGBT 单管及模块、整流桥和 MOSFET 器件。（新浪、宏微科技）

8、Meta 推出全新的“Meta Glasses”系列智能眼镜

2026 年 6 月 23 日消息，Meta 推出全新的 "Meta Glasses" 系列智能眼镜，由 Meta 与 EssilorLuxottica 合作制造，售价 299 美元。

Meta Glasses 没有屏幕，但配备摄像头和个人扬声器；设有专用按钮，默认触发 Meta AI 助手，也可自定义为启动特定功能；单次充电超过 8 小时，便携充电盒可提供额外 40 小时续航；新增支持 14 种语言 的实时翻译，包括日语、中文（普通话）、印地语和韩语等。（新浪）

9、苹果部分 Mac、iPad 涨价

2026 年 6 月 25 日消息，受内存、存储芯片价格暴涨影响，苹果将 Mac 电脑、iPad 产品售价上调 15% 至 25%。

具体调价明细：入门款 MacBook Air 涨价 200 美元，现价 1299 美元；基础版 MacBook Pro 涨价 300 美元，现价 1999 美元；入门级 MacBook Neo 涨价 100 美元，现价 699 美元。iPad Air 涨价 150 美元，现价 749 美元；iPad Pro 涨价 200 美元，现价 1199 美元。

苹果在声明中表示：“我们如今不得不启动产品涨价。我们从未见过零部件价格在如此短

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

的时间内出现如此大幅度的上涨。”（新浪）

10、韩国宣布 AI 超级投资规划

2026 年 6 月 29 日消息，韩国产业通商资源部长金正官表示，韩国将投入 800 万亿韩元在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造厂，打造继首都圈之后全国第二大半导体产业集群，其中三星电子、SK 海力士共同拿出 81 万亿韩元布局忠清道先进封装基地，专门承接 AI 高带宽存储（HBM）扩产配套需求。

这 800 万亿韩元主要投向光州前道晶圆制造环节，由三星、SK 海力士各承建两座晶圆厂，缓解韩国当下首都圈龙仁、平泽厂区电力、工业用水资源饱和、无法持续扩容的瓶颈。81 万亿韩元专项划拨忠清道，建设规模化先进封装集群，匹配 HBM 堆叠生产需求；另有配套 30 万亿韩元专项资金，未来 15 年覆盖芯片研发、设计、测试全链条扶持。

本次半导体产业投资规划，是韩国政府推出的“三大超级国家级项目”核心内容之一。该规划推动三星电子、SK 海力士两大芯片龙头及多家企业，分别布局半导体产业、实体人工智能、人工智能数据中心三大赛道的大规模投资。

据金正官介绍，政府将为企业投资提速，把新建晶圆厂的落地建设周期大幅提前最长 12 年：原计划 2040 年代中后期竣工投产，现调整至 2030 年代中期完成。

同日，三星集团正式宣布投资计划，总额达 2655 万亿韩元，将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资 2030 万亿韩元。

三星电子会长李在镕表示，当前产能已不足以满足市场需求，公司正考虑在韩国光州建设新的投资基地；同时计划在龟尾推进机器人投资、在仁川布局生物医药投资，并考虑在蔚山投资电池业务、在釜山投资半导体基板业务。

而 SK 集团会长崔泰源则表示，该公司计划新增 1100 万亿韩元投资，用于新建多处半导体产业集群，其中 400 万亿韩元将投至韩国西南部地区。

崔泰源表示，集团计划到 2035 年建成 15 吉瓦（GW）AI 数据中心容量，并将其打造为韩国国家级基础设施和“实体 AI（Physical AI）时代”的核心底座。崔泰源称，该计划总投资规模将达到 1000 万亿韩元。（界面新闻）

11、SK 海力士拟订购 4000 亿韩元半导体检测设备

2026 年 6 月 30 日消息，据 TheElec 报道，SK 海力士正在与半导体设备厂商讨清州 P&T7 工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约 200 台设备，其中包括 HBM4 测试仪。按每台 15 亿至 20 亿韩元的价格计算，总价最高可达 4000 亿韩元。（TheElec，财联社）

4.2. 河南省半导体行业动态

1、中科粉研第四代半导体材料生产基地落户郑州高新区，政产学研协同攻坚“终极半导体”

仅供内部参考，请勿外传！

2026 年 6 月 26 日消息，河南省郑州高新技术产业开发区与中科粉研（河南）超硬材料有限公司正式签署协议，中科粉研第四代半导体材料生产基地落户郑州市高新区。签约仪式在郑州高新区举行。这标志着我国在第四代半导体材料领域迈出从技术研发到规模化生产的关键一步，为破解“卡脖子”难题、抢占全球半导体产业制高点注入强劲动力。

第四代半导体材料以金刚石、氧化镓等超宽禁带材料为核心，具备禁带宽度大、击穿电场高、热导率优异等特性，在 AI 芯片、5G/6G 通信、电子热管理、新能源汽车、航天军工、生物医药等极端应用场景中具有不可替代的优势，被誉为“终极半导体材料”。本次签约落地的生产基地，将依托中科粉研全球首条 LPPHT 微纳米金刚石产线的技术积累，为实现第四代半导体核心材料的自主开发、自主创新、自主生产、规模量产打下坚实基础。

中科粉研是国内具备从金刚石 CVD 装备、长晶、外延、微纳加工到先进封装基板全链条垂直整合能力的高科技企业，由中南大学参股，定位为“国际前沿的金刚石功能材料系统制造商”。中科粉研董事长陈泽民表示：“科技报国、实业兴邦，是不变的初心。此次基地建设将推动微纳米金刚石从实验室走向大规模产业化，本基地投资 15 亿元，具备 500 台 MPCVD 生产 2 英寸到 4 英寸的单晶晶圆和 50 条 LPPHT 生产微米/纳米球形金刚石的能力，今年底 200 台 MPCVD 将投产，三年内年产值将达 30 亿元，为战略性新兴产业装上‘中国芯’提供关键材料支撑。同时将与中南大学合作，建立首个国家级金刚石科技博物馆”。

郑州高新区党工委副书记、管委会主任孙涵表示，基地落地是高新区落实国家创新驱动发展战略、推动产学研深度融合的重要成果。郑州作为全国超硬材料产业发源地和核心集聚区，将全力支持项目建设，打造全国第四代半导体材料产业高地。

据悉，该生产基地将与此前挂牌的“中南大学—中科粉研第四代半导体材料研发中心”形成联动，构建“基础研究—技术攻关—成果转化—规模量产”全链条创新体系。研发中心已聚焦 MPCVD 金刚石制备、大尺寸单晶生长、器件集成等关键领域开展攻关，实行“双导师制”联合培养专业人才。

此次签约是继 3 月 31 日全球首条 LPPHT 微纳米金刚石产线在郑州高新区启动后，中科粉研与郑州高新区在第四代半导体领域的又一里程碑事件。从研发中心挂牌到产线启动再到生产基地签约，郑州高新区正加速形成第四代半导体材料产业集群，助力河南从金刚石产能大省向高端功能材料强省跨越。

世界金刚石看中国，中国金刚石看河南。随着第四代半导体材料生产基地的签约建设，郑州将在全球半导体产业竞争中书写属于中国的“硬核”答卷。（郑州高新技术产业开发区管理委员会）

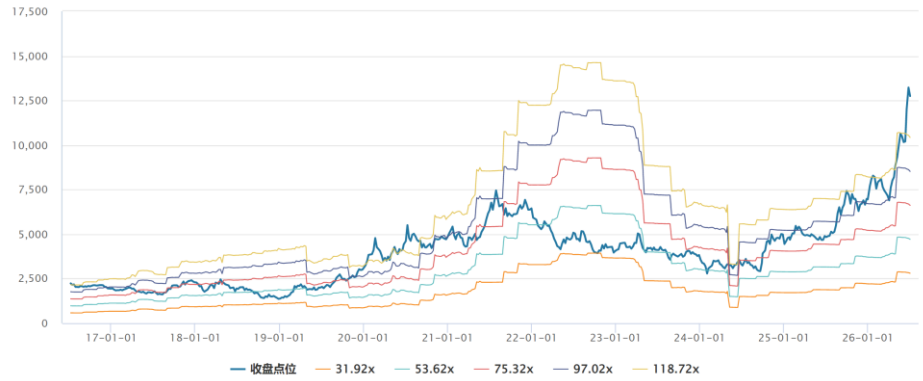
5. 估值分析与投资建议

5.1. 估值分析

仅供内部参考，请勿外传！

目前半导体行业 PE 估值高于近十年中位值及平均值。目前申万半导体行业 PE（TTM）约为 145 倍，近十年申万半导体行业 PE（TTM）最大值约为 165 倍、最小值约为 32 倍，申万半导体行业 PE（TTM）近十年中位值约为 75 倍、平均值约为 79 倍，目前半导体行业 PE 估值高于近十年中位值及平均值。

图 62：近十年半导体（申万）PE Bands



资料来源：Wind，中原证券研究所（截至 2026 年 7 月 3 日）

5.2. 投资建议

近日韩国宣布 AI 超级投资规划，韩国将投入 800 万亿韩元在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造厂；同时三星集团计划投资总额达 2655 万亿韩元，其中计划投资 2030 万亿韩元在韩国龙仁市和平泽市建设半导体产业集群；SK 集团计划投资总额达 2100 万亿韩元，其中计划 1100 万亿韩元用于新建多处半导体产业集群。美光上调 2027 财年资本支出计划，预计将超过 400 亿美元。受益于 AI 基础设施投资的不断扩张，AI 驱动对先进存储需求持续旺盛，全球存储制造商正在加速扩大产能，根据 SEMI 的最新预测，预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资将达到 520 亿美元，同比增长 29%，预计 2024-2029 年复合增速将达 19%。AI 驱动全球存储厂商加速扩产，半导体设备供给紧张程度有望逐步提升，国产半导体设备出海有望加速，同时叠加半导体设备国产替代在持续推进中，建议关注国内半导体设备及零部件厂商的投资机会。

6. 风险提示

下游需求不及预期；

市场竞争加剧风险；

国内厂商研发进展不及预期；

国产化进度不及预期；

国际地缘政治冲突加剧风险。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

仅供内部参考，请勿外传！

行业投资评级

强于大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 涨幅 10%以上；
同步大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 涨幅－10%至 10%之间；
弱于大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 跌幅 10%以上。

公司投资评级

买入：　未来 6 个月内公司相对沪深 300 涨幅 15%以上；
增持：　未来 6 个月内公司相对沪深 300 涨幅 5%至 15%；
谨慎增持：未来 6 个月内公司相对沪深 300 涨幅－10%至 5%；
减持：　未来 6 个月内公司相对沪深 300 涨幅－15%至－10%；
卖出：　未来 6 个月内公司相对沪深 300 跌幅 15%以上。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券分析师执业资格，本人任职符合监管机构相关合规要求。本人基于认真审慎的职业态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑，独立、客观的制作本报告。本报告准确的反映了本人的研究观点，本人对报告内容和观点负责，保证报告信息来源合法合规。

重要声明

中原证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告由中原证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证所含的信息不会发生任何变更。本报告中的推测、预测、评估、建议均为报告发布日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收益可能会波动，过往的业绩表现也不应当作为未来证券或投资标的表现的依据和担保。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告所含观点和建议并未考虑投资者的具体投资目标、财务状况以及特殊需求，任何时候不应视为对特定投资者关于特定证券或投资标的的推荐。

本报告具有专业性，仅供专业投资者和合格投资者参考。根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，本报告作为资讯类服务属于低风险（R1）等级，普通投资者应在投资顾问指导下谨慎使用。

本报告版权归本公司所有，未经本公司书面授权，任何机构、个人不得刊载、转发本报告或本报告任何部分，不得以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的刊载、转发，本公司不承担任何刊载、转发责任。获得本公司书面授权的刊载、转发、引用，须在本公司允许的范围内使用，并注明报告出处、发布人、发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下简称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为其发送行为负责，提醒通过该种途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过该种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

特别声明

在合法合规的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问等各种服务。本公司资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或者建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到潜在的利益冲突，勿将本报告作为投资或者其他决定的唯一信赖依据。